

股票代码：688655

股票简称：迅捷兴



深圳市迅捷兴科技股份有限公司

Shenzhen Xunjiexing Technology Corp. Ltd.

(深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A
座24楼)

2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票

募集说明书

(申报稿)

保荐人（主承销商）



(中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号)

二〇二六年九月

声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。

一、关于公司本次向特定对象发行股票的规模

本次以简易程序向特定对象发行的股票数量为 3,456,527 股，发行价格为 37.61 元/股，发行对象拟认购金额合计为人民币 13,000.00 万元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

二、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）经营业绩亏损风险

报告期内，公司实现营业收入 46,411.80 万元、47,458.50 万元、68,913.22 万元和 51,879.54 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 1,346.97 万元、-197.40 万元、-2,237.90 万元和 1,426.35 万元。最近两年净利润为负，主要系公司仍然处于产能爬坡阶段，人工、折旧等固定成本未被摊薄，叠加原材料价格上涨，导致公司毛利偏低；同时公司处于业务拓展期，各项期间费用不同程度增加，叠加资产及信用减值损失增加等多重因素综合影响。从中长期来看，全球 PCB 行业仍呈现增长趋势。然而，若公司未能通过加快市场开拓等提高产能利用率，公司业绩将可能继续亏损。

（二）毛利率下降的风险

报告期，公司主营业务毛利率分别为 15.14%、14.33%、8.52%和 10.43%，整体呈下降趋势。尽管公司毛利率水平处于同行业合理区间，且公司每年投入

大量的研发费用来对产品进行优化升级，但若未来行业竞争加剧导致产品销售价格下降，而公司未能及时通过提升订单和产品结构有效参与市场竞争；或者原材料价格上升，而公司未能有效控制产品成本等情况发生，公司毛利率将存在下降的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

（三）应收票据及应收账款无法收回的风险

公司根据客户的历史交易记录和销售规模，给予客户一定的货款结算周期。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 13,811.73 万元、13,837.49 万元、21,528.03 万元和 29,569.65 万元，公司应收票据账面价值分别为 4,623.12 万元、3,061.90 万元、4,176.90 万元和 4,785.76 万元，应收账款和应收票据合计占各期流动资产的比例分别为 41.84%、42.64%、46.03%和 47.56%。公司的应收票据、应收账款占公司流动资产的比例较大。未来随着公司经营规模的扩大，应收账款余额和应收票据将随之增长。如果主要客户的财务状况突然出现恶化，将会给公司带来应收票据、应收账款无法及时收回的风险。

（四）市场竞争风险

PCB 行业竞争激烈，行业格局正朝着“大型化、集中化”方向发展。行业龙头企业通过技术创新、规模扩张及供应链整合不断增强市场影响力，而中小企业则面临更大生存压力。若公司未能及时把握市场机遇，持续进行资金投入及技术研发，快速适应产品开发和市场策略的变化，可能会在市场竞争中失去优势，出现订单下滑、收入利润下降进而导致市场份额缩减的风险。

（五）募投项目效益未达预期的风险

公司本次募投项目效益测算系基于公司历史实际经营情况和未来行业发展状况所作出的预测，未来是否与预期一致存在不确定性。虽然公司对项目的可行性作出了充分论证、对经济效益测算进行了审慎分析，但如果未来印刷电路板市场环境出现重大变化，竞争格局、市场需求、产品价格、原材料成本等方面出现重大不利变化，则公司可能面临募投项目效益不及预期的风险。

（六）产能无法消化风险

公司本次募集资金投资项目涉及的相关产品产能设计主要结合公司对上述产品未来的市场需求规模、公司预期可能实现的市场占有率等因素综合确定。

公司光模块领域新增客户目前大多处于测试阶段，如公司未来产品市场开拓进展不及预期，新客户导入量产的转换率低，或现有产品的市场份额未继续提升甚至下滑，则可能导致公司本次募集资金投资项目的新增产能无法得到较好利用，进而对项目的预期收益带来不利影响。

目录

声明	1
重大事项提示	2
一、关于公司本次向特定对象发行股票的规模	2
二、特别风险提示	2
目录	5
释义	8
一、常用词汇	8
二、专业词汇释义	8
第一节 发行人基本情况	10
一、发行人基本信息	10
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况	10
三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况	11
四、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容	27
五、现有业务发展安排及未来发展战略	36
六、截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资的基本情况 ...	39
七、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施	43
八、同业竞争情况	45
第二节 本次证券发行概要	48
一、本次发行的背景和目的	48
二、发行对象与发行人的关系	51
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期	51
四、募集资金数额及用途	53
五、本次发行是否构成关联交易	53
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化	53
七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件	54
八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	54
九、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件的说明	54

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	63
一、本次募集资金使用计划	63
二、本次募集资金投资项目的具体情况	63
三、募集资金用于扩大既有业务的情况	70
四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式	70
五、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式	72
六、本次募集资金用于研发投入的情况	73
七、发行人主营业务及本次募投项目不涉及产能过剩行业，限制类、淘汰类行业，高耗能高排放行业	73
八、本次募集资金投资项目可行性分析结论	73
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	75
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划	75
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化	75
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况	75
四、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况	75
五、本次发行完成后，公司科研创新能力的变化	76
第五节 最近五年内募集资金运用的基本情况	77
一、最近五年内募集资金运用的基本情况	77
二、前次募集资金基本情况	77
三、前次募集资金投资项目实现效益情况	79
四、前次募集资金投资项目变更情况	80
五、闲置募集资金的使用情况	82
六、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用	83
七、会计师事务所出具的专项报告结论	83
第六节 与本次发行相关的风险因素	85
一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素	85

二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素	87
三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素	88
第七节 与本次发行相关的声明	90
一、发行人及全体董事、高级管理人员声明	90
二、发行人控股股东、实际控制人声明	95
三、保荐人（主承销商）声明	98
四、发行人律师声明	100
五、审计机构声明	101
六、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺	102
七、发行人控股股东、实际控制人承诺	103
八、发行人董事会声明	107

释义

在本募集说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

一、常用词汇

发行人、公司、本公司、迅捷兴	指	深圳市迅捷兴科技股份有限公司
信丰迅捷兴	指	信丰迅捷兴电路科技有限公司，为公司全资子公司
珠海迅捷兴	指	珠海市迅捷兴电路科技有限公司，为公司全资子公司
捷兴投资	指	泰安市捷兴投资合伙企业（有限合伙），曾用名深圳市吉顺发投资合伙企业(有限合伙)，公司员工持股平台
迅兴投资	指	泰安市迅兴投资合伙企业（有限合伙），曾用名深圳市莘兴投资合伙企业(有限合伙)，公司员工持股平台
新芮科技	指	中山市新芮科技有限公司，公司参股企业，持股比例为45%
骅富兴	指	深圳市骅富兴新能源科技有限公司，公司参股企业，持股比例为40%
航盛电子	指	深圳市航盛电子股份有限公司，公司参股企业
诺沛芯材	指	广东诺沛芯材有限公司，公司参股企业
云智光联	指	武汉云智光联科技有限公司，公司参股企业
公司章程	指	《深圳市迅捷兴科技股份有限公司公司章程》
保荐机构（主承销商）	指	国联民生证券承销保荐有限公司
发行人律师	指	广东信达律师事务所
会计师、华兴会计师事务所	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票/本次发行	指	深圳市迅捷兴科技股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票
A 股	指	每股面值 1.00 元人民币之普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
证监会或中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期、最近三年及一期	指	2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-6 月

二、专业词汇释义

印制电路板/PCB	指	英文全称“Printed Circuit Board”，指组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，又可称为“印制线路板”、“印刷线路板”
双面板	指	英文名称“Double-Sided Boards”，即在基板两面形成导体图案的PCB，两面间一般有适当的导孔（via）相连
多层板	指	英文名称“Multi-Layer Boards”，即具有更多层导电图形的 PCB，生

		产中需采用定位技术将 PCB、绝缘介质交替粘结并根据设计要求通过适当的导孔 (via) 互联
刚性板	指	英文名称“Rigid PCB”，由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板，其优点为可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑，又称为“硬板”
挠性板/挠性电路板	指	英文名称“Flexible PCB”，由柔性基材制成的印制电路板，其优点是可以弯曲，便于电器部件的组装，又称为“软板”
刚挠结合板	指	英文名称“Rigid-flex PCB”，由刚性板和挠性板有序地层压在一起，并以金属化孔形成电气连接的电路板，又称为“软硬结合板”
金属基板	指	英文名称“Metal base PCB”，其基材是由电路层（铜箔）、绝缘基层和金属底板三部分构成，其中金属基材作为底板，表面附上绝缘基层，与基层上面的铜箔层共同构成导通线路，铜面上可以安装电子元器件；目前应用最广泛的是铝基板
HDI 板	指	英文名称“High Density Interconnect”，通常指孔径在 0.15mm(6mil) 以下（大部分为盲孔）、孔环之环径在 0.25mm(10mil) 以下的微孔，接点密度在 130 点/平方英寸以上，布线密度在 117 英寸/平方英寸以上的多层印制电路板
厚铜板	指	任何一层铜厚为 30Z 及以上的印制电路板。厚铜板可以承载大电流和高电压，同时具有良好的散热性能
高频板	指	指专门用于传输和处理高频信号（通常指频率在 1GHz 以上）的特种印刷电路板
高速板	指	指专门为传输高频信号或快速上升/下降沿的数字信号而设计和制造的印刷电路板
封装基板	指	直接用于搭载芯片，可为芯片提供电连接、保护、支撑、散热、组装等功效，以实现多引脚化，缩小封装产品体积、改善电性能及散热性、超高密度或多芯片模块化的目的
覆铜板/基板/基材	指	英文名称“Copper Clad Laminate”，为制造 PCB 的基本材料，具有导电、绝缘和支撑等功能，可分为刚性材料（纸基、玻纤基、复合基、陶瓷和金属基等特殊基材）和柔性材料两大类
半固化片/PP	指	又称为“PP 片”或“树脂片”，是制作多层板的主要材料，主要由树脂和增强材料组成，增强材料又分为玻纤布、纸基、复合材料等几种类型。制作多层印制板所使用的半固化片大多采用玻纤布做增强材料
盲孔	指	连接表层和内层而不贯通整板的导通孔。盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面，具有一定深度，用于表层线路和下面的内层线路的连接
埋孔	指	连接内部任意电路层间但未导通至外层的导通孔，用于内层信号互连，可以减少信号受干扰的几率，保持传输线特性阻抗的连续性，并节约走线空间，适用于高密高速的印制电路板
电镀	指	一种电离子沉积过程，利用电极通过电流，使金属附着在物体表面上，其目的为改变物体表面的特性或尺寸
OZ	指	盎司，作为长度单位时，10Z 代表 PCB 的铜箔厚度约为 36 μm
Mil	指	PCB 行业的一种长度计量单位，1mil=0.025mm
IC	指	集成电路，Integrated Circuit 的缩写
CPCA	指	中国电子电路行业协会

注：本募集说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	深圳市迅捷兴科技股份有限公司
英文名称	Shenzhen Xunjiexing Technology Corp. Ltd.
上市地点	上海证券交易所
证券简称	迅捷兴
证券代码	688655
法定代表人	马卓
成立时间	2005 年 8 月 19 日
股本总额	13,339.00 万股
注册地址	深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 24 楼
经营范围	一般经营项目是：电路设计；线路板及电子元器件的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：电路设计；电子元器件的生产；线路板的生产。
统一社会信用代码	91440300778785072F
电话号码	0755-33653366
传真号码	0755-33653366-8822
公司网址	www.jxpcb.com
电子信箱	zqb@jxpcb.com

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）股本结构

截至 2026 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：

股份类别	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	—	—
二、无限售条件流通股份	133,390,000	100.00%
三、普通股股份总数	133,390,000	100.00%

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	马卓	51,573,100	38.66
2	杨春光	3,807,200	2.85
3	中国工商银行股份有限公司—财通新视野灵活配置混合型证券投资基金	3,603,250	2.70
4	李雪梅	3,040,100	2.28

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
5	捷兴投资	2,543,699	1.91
6	马颖	1,903,600	1.43
7	宁波银行股份有限公司一财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金	924,539	0.69
8	王玉良	890,000	0.67
9	郑波杰	865,183	0.65
10	迅兴投资	796,646	0.60
合计		69,947,317	52.44

（二）控股股东及实际控制人

公司的控股股东、实际控制人为马卓先生。截至 2026 年 6 月 30 日，马卓先生直接持有公司 5,157.31 万股股份，持股比例为 38.66%；通过捷兴投资、迅兴投资分别间接持有公司 72.80 万股股份、31.88 万股股份，持股比例分别为 0.55%、0.24%，合计持有公司 5,261.99 万股股份，持股比例为 39.45%。马卓先生的基本情况如下：

马卓先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 22022219750725****，毕业于长春理工大学，大专学历。1999 年 6 月至 2002 年 6 月任深圳市兴森快捷电路技术有限公司销售经理；2003 年 7 月至 2005 年 7 月创立并任深圳市捷兴电子有限公司总经理；2005 年 8 月至今任职于公司，现任公司董事长兼总经理。

发行人控股股东、实际控制人自上市以来未发生变更。

（三）控股股东及实际控制人所持发行人股份质押、冻结情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人所持发行人股份不存在股份质押、冻结的情况。

三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况

公司主营业务为印制电路板的研发、生产与销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”之“C3982 电子电路制造”。

（一）所处行业的主要特点

1、行业监管体制和主要法律法规及政策

（1）行业主管部门

中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）是印制电路板行业的主管部门，其主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

（2）行业自律组织

中国电子电路行业协会（以下简称“CPCA”）是行业自律组织，隶属工信部业务主管领导的具有独立法人资格的国家一级行业协会。CPCA以推进印制电路行业的改革与发展、加速印制电路行业的现代化建设为宗旨，主要职能包括：向政府反映企事业单位的愿望和要求，向企事业单位传达政府的政策和意图，协助政府部门对印制电路行业进行行业管理；向政府部门提出制定行业规划、经济和技术政策、技术标准及经济立法等方面的建议，并参与相应活动；向有关部门和会员单位提供情况、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作等。

（3）最近三年行业主要政策及法律法规

印制电路板在连接各种元器件中起着关键作用，是现代电子设备的重要组成部分。电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，印制电路板作为电子信息产业的基础产品，国家相继推出了一系列扶持和鼓励印制电路板行业发展的产业政策，从而推进行业的产业升级及战略性调整。我国支持印制电路板产业发展的有关政策，具体如下：

序号	时间	部门	政策名称	有关内容
1	2025 年 11 月	工信部	《印制电路板行业规范条件》 (2025 年)	推动印制电路板产业高端化、绿色化、智能化发展，引导产业加快转型升级

2	2025 年 10 月	中共中央	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
3	2025 年 8 月	工信部、市场监督管理总局	《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》	持续支持集成电路、先进计算、未来显示、新型工业控制系统等领域科技创新。提升协同攻关效率，支持人工智能、先进存储、三维异构集成芯片、全固态电池等前沿技术方向基础研究。
4	2025 年 4 月	工信部	《电子信息制造业数字化转型实施方案》	重点支持新一代信息通信、集成电路、先进电池材料等作为主导产业的国家高新区及其他重点园区，加快先进计算中心、新一代移动通信、工业互联网等新型基础设施规模化建设应用。深化先进计算、智能控制、人机交互、大数据等技术在人工智能终端产品中的应用，加快发展智能传感器、智能移动终端、智能语音交互系统、智能可穿戴设备等。
5	2024 年 2 月	国务院办公厅	《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》	积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单，允许享受相应支持政策
6	2024 年 1 月	工信部、教育部、科技部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	加快实施重大技术装备攻关工程，突破人形机器人、量子计算机、超高速列车、下一代大飞机、绿色智能船舶、无人船艇等高端装备产品，以整机带动新技术产业化落地，打造全球领先的高端装备体系。深入实施产业基础再造工程，补齐基础元器件、基础零部件、基础材料、基础工艺和基础软件等短板，夯实未来产业发展根基。
7	2023 年 12 月	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	属于鼓励类目录中的“二十八、信息产业·5、新型电子元器件制造：片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高分子固体电容器、超级电容器、无源集成元件、高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路（线宽/线距≤0.05mm）柔性电路板、太阳能电池、锂离子电池、钠离子电池、燃料电池等化学与物理电池等”
8	2023 年 10 月	工信部等六部门	《算力基础设施高质量发展行动计划》	强化存力高效灵活保障：加速存力技术研发应用、持续提升存储产业能力、推动存算网协同发展。存储力方面，存储总量超过 1800EB，先进存储容量占比达到 30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到 100%。

9	2023 年 6 月	工 信 部、教 育 部、 科 技 部、财 政 部、 国 家 市 场 监 督 管 理 总 局	《制造业可靠性 提升实施意见》	聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。提升高频高速印刷电路板及基材、新型显示专用材料、高效光伏电池材料、锂电关键材料、电子浆料、电子树脂、电子化学品、新型显示电子功能材料、先进陶瓷基板材料、电子装联材料、芯片先进封装材料等电子材料性能，提高元器件封装及固化、外延均匀、缺陷控制等工艺水平，加强材料分析、破坏性物理分析、可靠性试验分析、板级可靠性分析、失效分析等分析评价技术研发和标准体系建设，推动在相关行业中的应用。
10	2023 年 2 月	中 共 中 央、国 务 院	《数字中国建设 整体布局规划》	夯实数字中国建设基础。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。
11	2023 年 1 月	工 信 部 等 六 部 门	《关于推动能源 电子产业发展的 指导意见》	加强面向新能源领域的关键信息技术产品开发和应用，主要包括适应新能源需求的电力电子、柔性电子、传感物联、智慧能源信息系统及有关的先进计算、工业软件、传输通信、工业机器人等适配性技术及产品

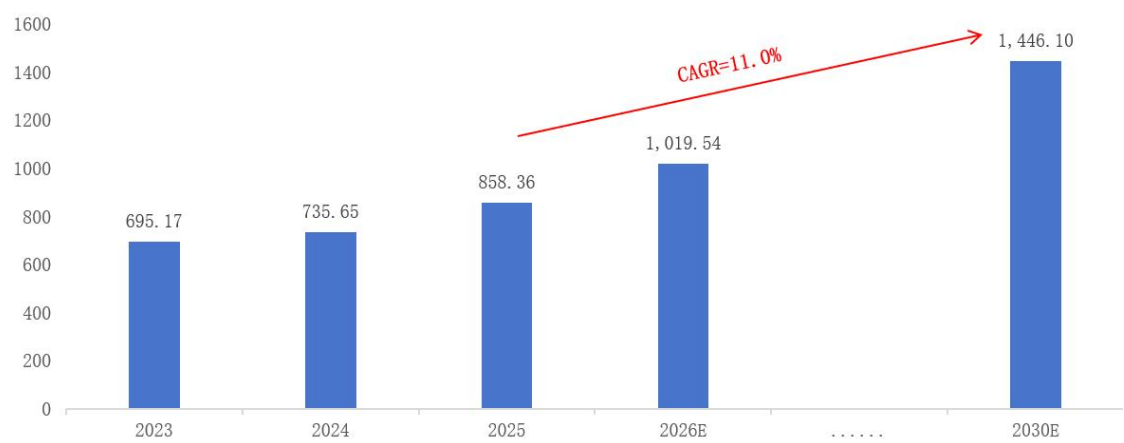
2、行业发展现状和发展趋势

（1）全球印制电路板发展概况

①PCB 全球市场空间广阔

PCB 行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业。2023 年，全球 PCB 产值为 695.17 亿美元。2024 年，受益于 AI 服务器及相关高速网络基础设施推动、智能手机市场复苏等，全球 PCB 产值达到 735.65 亿美元，同比增长 5.8%。2025 年，全球 PCB 市场增长进一步提速，全球 PCB 产业产值同比增长 16.7%，产值达到约 858.36 亿美元。2025 年，PCB 行业迎来显著加速发展，这主要得益于对人工智能相关产品需求的激增——包括 AI 服务器、高性能计算设备、数据中心网络解决方案以及先进半导体封装技术。高层数服务器 PCB、先进 HDI 板、ABF 封装基板、光模块以及卫星通信应用领域的需求推动了全年行业的强劲增长。预计 2026 年全球 PCB 市场产值同比增长 18.8%，达到 1,019.54 亿美元。2023 年至 2030 年，全球 PCB 行业产值及其变化情况如下图所示：

2023-2030 年全球 PCB 产值及增长率



数据来源：Prismark

②全球 PCB 产业向亚洲特别是中国大陆转移

PCB 产业在全球范围内广泛分布，美欧日发达国家和地区起步早。2000 年以前，美洲、欧洲和日本三大地区占据全球 PCB 产值的 70%以上。但近二十年来，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国大陆、中国台湾和韩国等亚洲地区进行转移。随着全球产业中心向亚洲转移，PCB 行业呈现以亚洲，尤其是中国大陆为制造中心的新格局。自 2006 年开始，中国大陆超越日本成为全球第一大 PCB 生产基地，PCB 的产量和产值均居世界第一。全球 PCB 产业迁移情况及预计增长率情况如下：

2025-2030 年 PCB 产业发展情况预测(按地区)

单位：亿美元

类型/年份	2025		2026E		2030F	2025-2030F
	产值	同比	产值	同比	产值	复合增长率
美洲	37.96	7.5%	41.59	9.5%	50.81	6.0%
欧洲	17.74	8.3%	20.94	18.0%	24.96	7.1%
日本	64.99	11.3%	77.47	19.2%	105.07	10.1%
中国大陆	496.52	20.9%	587.81	18.4%	817.64	10.5%
亚洲（日本、中国大陆除外）	241.14	12.3%	291.73	21.0%	447.62	13.2%
合计	858.36	16.7%	1,019.54	18.8%	1,446.10	11.0%

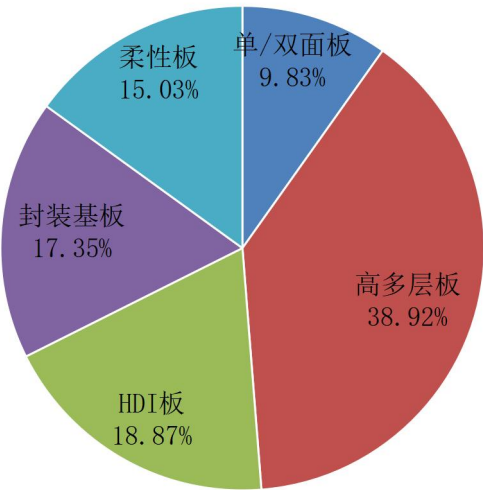
数据来源：Prismark

2025 年中国大陆 PCB 产值占全球 PCB 总产值的比例为 57.85%，2026 年预计达 57.65%。2030 年预计达 56.54%，仍是全球最大生产基地。据 Prismark 预测，未来五年亚洲将继续主导全球 PCB 市场的发展，而中国的核心地位更加稳固，中国大陆 PCB 行业预计复合年均增长率为 10.49%，至 2030 年行业总产值将达到 817.64 亿美元。

③全球 PCB 产品结构及变化趋势

根据 Prismark 的数据，2025 年全球 PCB 细分产品的市场结构如下：

2025 年全球 PCB 细分产品结构



数据来源：Prismark

从产品结构来看，刚性板占市场主流地位，其中多层板占比 38.92%，单/双面板占比 9.83%；其次是封装基板，占比达 17.35%；HDI 板和柔性板分别占比为 18.87%和 15.03%。

随着电子电路行业技术的迅速发展，终端应用产品呈现小型化、智能化趋势，市场对高密度、高多层、高技术 PCB 产品的需求将变得更为突出，HDI 板、封装基板等技术含量更高的产品增长速度将更快，未来在 PCB 行业中占比将进一步提升。根据 Prismark 预测，2025 年至 2030 年全球 PCB 产品细分领域产值增长情况如下所示：

单位：亿美元

产品类型	2025 年	2030F	预计复合年均增长率
单/双面板	84.40	103.44	4.2%

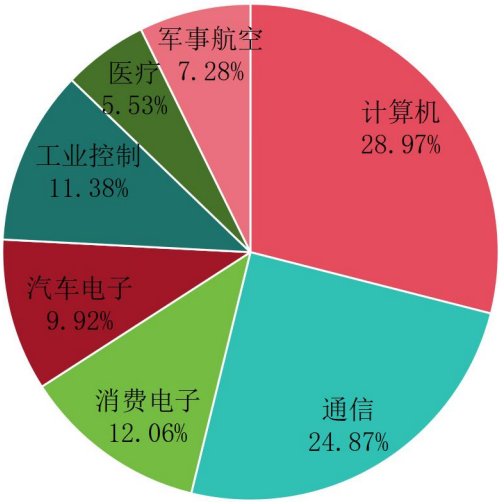
高多层板	334.05	585.63	11.9%
HDI 板	161.97	300.10	13.1%
封装基板	148.91	296.10	14.7%
柔性板	129.03	160.83	4.5%
合计	858.36	1,446.10	11.0%

如上表所示，高端 PCB 产品如 HDI 板及 IC 载板增速最快。未来无线通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶以及消费电子等市场仍将是 PCB 行业长期的重要增长驱动力。为适应不同领域的需求，PCB 正向着高速、高频、集成化、小型化和轻薄化的方向发展，高多层、高频高速、HDI 板、IC 载板等中高端 PCB 产品将保持强劲增长趋势。2030 年 HDI 板的市场产值将分别达到 300.10 亿美元，2025-2030 年的复合增长率为 13.1%。

④全球 PCB 下游应用领域

全球 PCB 下游应用领域分布广泛，主要包括通信、计算机、消费电子、汽车电子、服务器、工业控制、军事航空、医疗等领域。下游电子系统市场持续扩张，为 PCB 行业增长提供基础支撑。根据 Prismark 数据，2025 年全球电子系统市场规模上调至 2.80 万亿美元，同比增长 9.8%，具体分布情况如下：

2025 年全球电子系统市场规模分布情况



数据来源：Prismark

从 PCB 下游应用领域来看，计算机和通信市场规模占比较大，占比分别为 28.97%和 24.87%，消费电子占比为 12.06%，工业控制占比为 11.38%，汽车电子占比为 9.92%，军事航空占比为 7.28%，医疗占比为 5.53%。

Prismark 预计，人工智能相关的服务器、数据中心及网络应用预计将持续成为 PCB 行业至 2030 年的主要增长动力。不过，增长范围并不局限于人工智能基础设施领域：智能手机、个人电脑及其他消费电子设备仍将推动 HDI 板需求；而智能手机、可穿戴设备以及模块化电子产品则仍是柔性电路和基板类产品的重要终端市场。尽管这些市场已较为成熟，但日益丰富的电子元件内容与人工智能功能预计将持续支撑 PCB 市场需求。

随着汽车架构向集中式计算和软件定义平台转型，汽车市场预计将继续成为 PCB 需求的重要来源。这一趋势将推动对多层板和 HDI 板的需求；同时，车辆电气化的发展预计将通过电池管理系统、电力电子器件及车载互连应用，持续推动柔性电路市场的增长。

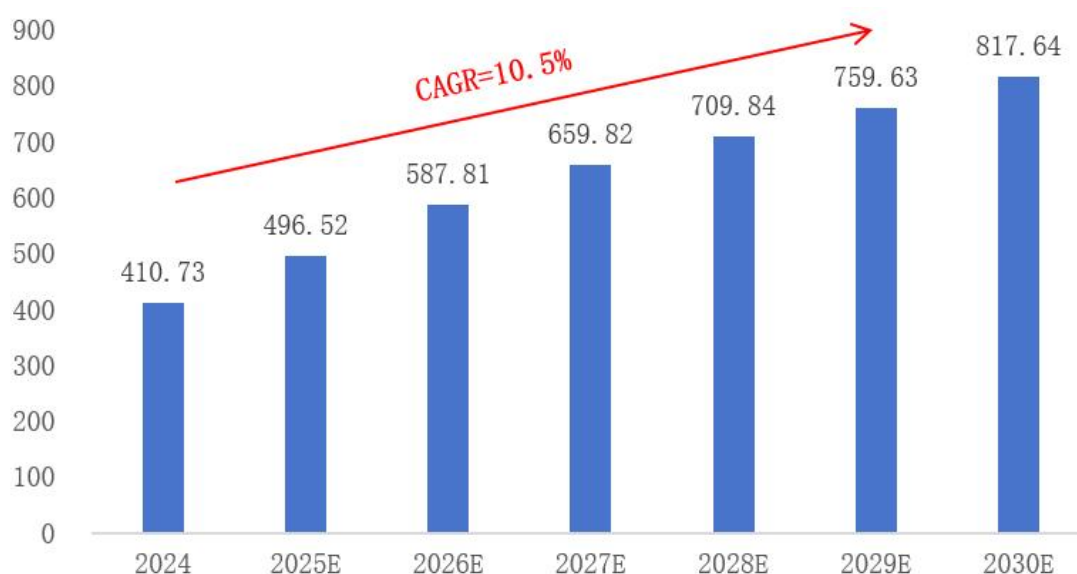
（2）中国大陆印制电路板发展概况

①中国大陆 PCB 市场增长迅速，已成为全球最大生产基地

受益于全球 PCB 产能向中国大陆转移以及下游电子终端产品制造业蓬勃发展，中国大陆 PCB 行业整体呈现较快的增长趋势，2006 年中国大陆 PCB 产值超过日本，成为全球第一大 PCB 制造基地。2024 年，PCB 行业迎来结构性复苏，中国大陆 PCB 行业产值为 410.73 亿美元。2025 年，中国大陆 PCB 行业产值为 496.52 亿美元，较上一年大幅增长，增长率约 20.89%，主要得益于对人工智能服务器、AI 加速器、高速网络设备、光模块、数据中心基础设施、汽车电子元件及通信设备的强劲需求。中国在基础型 PCB、多层板、HDI 和柔性电路领域持续保持领先地位，并在先进封装基板领域迅速提升市场地位。

据 Prismark 预测，未来五年中国大陆 PCB 行业仍将持续增长，预计 2025 年至 2030 年复合年均增长率为 10.5%，2030 年中国大陆 PCB 产值将达到 817.64 亿美元。

2024-2030 年中国大陆 PCB 产值及增长率



数据来源：Prismark

②中国 PCB 产业区域分布

中国的改革开放从沿海地区起步，沿海地区凭借国家政策支持、便利的基础交通设施、完善的配套产业链以及劳动力优势，成为电子制造行业崛起的试验田，PCB 作为电子制造行业的基础部件，也率先在长三角、珠三角等沿海发达地区起步。近年来，随着长三角、珠三角地区劳动力成本的上升和环保排污指标总量控制等政策，以及内地不断提高的产业链配套服务水平，部分 PCB 生产企业开始将部分产能转移至具备产业链配套条件的内地城市，如江西、湖北、湖南、四川、重庆等地。

江西省作为唯一一个与长三角、珠三角和闽南三角区毗邻的省份，是沿海城市向中部地区延伸的重要地带，在我国产业竞争格局中拥有独特的区位优势 and 资源优势，加上地方政府大力推动 PCB 相关产业招商引资，电子信息产业集群已初具规模，PCB 产能呈现快速增长的发展势头，江西省逐渐成为沿海城市 PCB 企业主要转移基地。未来中西部地区将有望建立完善的 PCB 产业链，发展成为我国 PCB 行业主要的生产制造基地，同时推动珠三角、长三角地区向高端应用产品和高技术附加值产品发展。

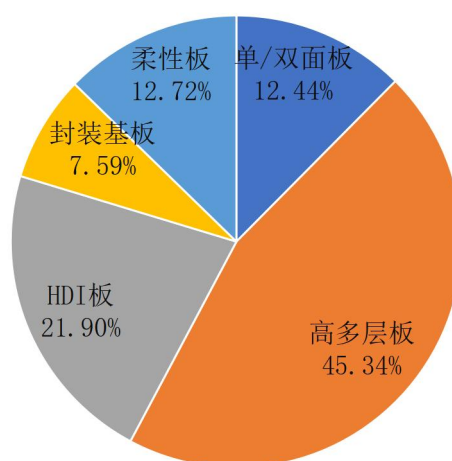
③中国大陆 PCB 细分产品结构

根据 Prismark 数据，2025 年我国刚性板的市场规模最大，其中多层板占

比 45.34%，单/双面板占比 12.44%；其次是 HDI 板，占比达 21.90%；封装基板和柔性板占比分别为 7.59%和 12.72%。

从中长期来看，人工智能服务器、高速网络和汽车系统的强劲需求将继续支持高端 HDI 细分市场的增长，Prismark 预测 2025-2030 年中国大陆 18 层及以上 PCB 板、HDI 板的年均复合增长率分别为 32.9%和 12.9%。

2025 年中国大陆 PCB 细分产品结构



资料来源：Prismark

（3）小批量板行业发展概况

小批量板行业的下游应用领域主要包括工业控制、交通、通信设备、医疗器械、汽车电子等领域，其中：通信设备、汽车电子领域对大批量板与小批量板均有需求。

小批量板行业的产品个性化程度高，有批量小、品种多、订单持续的特点。下游领域的持续发展使得小批量板市场的需求稳步增长；同时，近年来消费者个性化需求增加，使得消费电子、计算机等领域对小批量的需求逐渐增加。

目前中国小批量板市场发展程度不如欧美、日本等国际市场，但是，中国优势小批量板企业已开始承接较多日本、欧美客户小批量板的订单。未来随着境内市场产业逐步升级，中国小批量板企业竞争力的提升，欧美及日本小批量板产能将继续加速向境内转移，上下游行业的快速发展为小批量行业的发展提供广阔的市场空间。

（二）行业竞争情况

1、行业竞争格局及行业内主要企业

（1）全球主要 PCB 企业情况

全球 PCB 行业分布地区主要为中国大陆、中国台湾、日本、韩国和欧美地区，目前中国是全球 PCB 行业产量最大的区域。

全球印制电路板行业集中度不高，生产商众多，市场竞争充分。虽然目前 PCB 行业存在向优势企业集中的发展趋势，但在未来较长时期内仍将保持较为分散的行业竞争格局。根据 Prismark 统计，2025 年全球前十大 PCB 厂商收入合计为 323.91 亿美元。2025 年全球前十大 PCB 厂商的销售情况如下：

2025 年全球前十大 PCB 厂商

单位：亿美元

排名	公司名称	国家/地区	营业收入	基本情况
1	ZD Tech（臻鼎）	中国台湾	58.69	富士康集团成员企业，主营柔性板、HDI 板、刚性板及封装基板
2	Unimicron（欣兴）	中国台湾	42.25	主营封装基板、HDI 板、多层板等
3	Dongshan Precision（东山精密）	中国大陆	35.70	2016 年完成对 FPC 厂商 MFLX 的私有化收购，2018 年完成对伟创力下属 PCB 业务主体 Multek 的收购，目前主营柔性板、刚性板
4	Shennan Circuit（深南电路）	中国大陆	32.95	内资厂商，A 股上市公司，主营印制电路板、电子装联、封装基板，生产基地分布在深圳、无锡、南通、广州
5	TTM Technologies（迅达）	美国	29.06	北美最大的电路板厂商，主营刚性板、HDI 板、柔性板等
6	WUS Group（沪电股份）	中国大陆	27.60	主营单双面板、多层及 HDI 板
7	Victory Giant Technology（胜宏科技）	中国大陆	26.86	主营高多层刚性板、高阶 HDI 板、柔性板及软硬结合板
8	Compeq（华通）	中国台湾	24.46	主营多层刚性板、HDI 板、软板与刚柔结合板等
9	Tripod（健鼎）	中国台湾	23.61	主营多层刚性板等
10	Nippon Mektron（旗胜）	日本	22.73	全球最大柔性板厂商
合计			323.91	-

数据来源：Prismark

（2）中国主要 PCB 企业情况

从中国大陆市场来看，PCB 企业大约有 1,500 家，主要分布在珠三角、长三角和赣湘地区，形成了中国台资、中国港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。其中，外资企业普遍投资规模较大，生产技术和产品专业性都有一定优势；内资企业数量众多，产业集中度低，在规模和技术水平上与外资相比仍存在差距。

根据 CPCA 公布的中国电子电路行业排行榜，2025 年中国大陆主要 PCB 厂商排名如下：

2025 年中国大陆 PCB 企业排名

单位：亿元

序号	公司名称	营业收入	基本情况
1	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	391.47	臻鼎的控股子公司，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在深圳、淮安、秦皇岛和营口
2	苏州东山精密制造股份有限公司	256.20	内资厂商，A 股上市公司，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在苏州、盐城和珠海
3	深南电路股份有限公司	236.47	内资厂商，A 股上市公司，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，生产基地分布在深圳、无锡、南通
4	胜宏科技（惠州）股份有限公司	192.92	内资厂商，A 股上市公司，主营产品为刚性电路板、柔性电路板、HDI 板等，生产基地分布在惠州。
5	沪士电子股份有限公司	189.45	中国台资控股厂商，A 股上市公司，主营单双面板、多层及 HDI 板，其大陆生产基地分布在昆山、黄石
6	健鼎科技股份有限公司	153.52	中国台资控股厂商，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在无锡、仙桃
7	深圳市景旺电子股份有限公司	153.08	内资厂商，A 股上市公司，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，生产基地分布在深圳、龙川、江西和珠海
8	华通电脑股份有限公司	125.63	中国台资控股厂商，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在重庆、苏州、惠州
9	欣兴电子股份有限公司	124.06	中国台资控股厂商，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在苏州、昆山和深圳
10	建滔集团有限公司	122.00	中国港资控股厂商，主营单双面板、多层及 HDI 板
合计		1,944.80	-

资料来源：CPCA

2、影响行业发展的有利和不利因素

（1）有利因素

①产业政策支持

电子信息产业是我国重点发展的战略性支柱产业，印制电路板行业作为电子产品的基础产品，受到国家政策的大力支持。我国先后通过出台《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《“十四五”数字经济发展规划》《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等政策方针，把 PCB 行业相关产品列为重点发展对象。“十四五规划”中提出要加快壮大新一代信息技术、新能源汽车等产业，“十五五规划”提出全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。国务院及相关部委推出了“基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）”“5G 应用‘扬帆’行动计划（2021-2023 年）”“新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）”“工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）”“电子信息制造业数字化转型实施方案”“电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案”等一系列产业政策和引导 5G 通信、新能源汽车、物联网、工业互联网等领域的发展。国家政策的扶持将为电子信息产业提供广阔的发展空间，推动了 PCB 行业的发展，助力电子制造业全面转型升级，国内 PCB 行业将借此契机不断提升企业竞争力。

②下游应用领域的不断发展

印制电路板的下游行业广泛，包括工业控制、汽车电子、通信设备、消费电子、军事航空、医疗器械等。广泛的应用分布为印制电路板行业提供巨大的市场空间，降低了行业发展的风险。随着 5G、云计算、大数据等技术的发展，对数据存储和计算力的需求呈高增长态势，服务器行业发展空间广阔。随着新能源汽车普及和汽车智能化程度加深，汽车电子行业对 PCB 的需求快速增长，如电池管理系统（BMS）、智能座舱、自动驾驶传感器等，对 PCB 的可靠性、耐高温性和信号完整性要求极高，推动了车用 PCB 技术升级和价值量提升。通信设备（尤其是 5G 基站建设、光模块）和消费电子（如智能手机、可穿戴设备）一直是 PCB 需求的基本盘，其市场规模庞大，需求稳定，随着技术的持续创新，

也在不断创造新的市场机会。PCB 应用行业的技术革新以及新兴产业的发展为 PCB 行业带来新机遇，为 PCB 市场发展提供了重要保障。

近年来，随着 5G/6G 通信、人工智能、云计算、自动驾驶等技术的快速迭代，PCB 在高速光模块、高速通信设备、AI 服务器等领域的应用持续深化。上述领域对 PCB 的层数、材料、工艺提出了更高要求（如高层数、高频高速、低损耗、高散热等），推动高端 PCB 产品需求快速增长。

③中国电子行业产业链完整

近年来，中国电子信息产业一直保持快速发展，带动了中国电子信息产业链的发展。目前，中国电子信息产业链已日趋完整，国内电子行业规模大、配套能力强，产业集聚效应明显。中国印制电路板行业上游行业发展迅速，主要原材料如覆铜板、半固化片、铜箔等厂商具备充分生产供应能力，能快速响应 PCB 企业的需求。PCB 行业作为电子信息产业的基础行业，在产业链中起着承上启下的关键作用，完整的产业链使 PCB 企业既能快速采购原材料，又能快速响应客户需求，保障 PCB 产业稳定发展。

④全球产能继续向中国大陆等地区转移

近二十余年，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子信息产业产能向中国大陆、中国台湾和韩国等亚洲地区进行转移。随着全球产业中心向亚洲转移，PCB 行业呈现以亚洲，尤其是中国大陆为制造中心的新格局。自 2006 年以来，中国超越日本成为全球第一大 PCB 生产国，PCB 的产量和产值均居世界第一。以长三角和珠三角为代表的中国大陆电子信息产业规模大、产业链完整、配套能力强，产业集聚效应明显。目前，中国大陆 PCB 产品呈现量大但技术含量较低的特点，随着中国大陆 PCB 企业的不断发展，预计未来全球 PCB 产能尤其是中高端 PCB 产能向中国大陆转移的趋势仍将持续。

（2）不利因素

①市场竞争加剧

全球 PCB 行业竞争格局较为分散，生产厂商众多，市场竞争较为充分，行业格局正朝着“大型化、集中化”方向发展，中小 PCB 企业面临更大生存压力。

在 AI 服务器、高速光模块、高速通信、智能汽车电子等新兴高端领域，由于对 PCB 的层数、材料、工艺提出了极高要求，技术壁垒和资金壁垒陡增，国内主流 PCB 厂商如深南电路、沪电股份、胜宏科技等正在增加资本开支，积极扩充高端产能，众多 PCB 厂商的加速切入，可能导致行业供给格局在未来趋于拥挤，未来 PCB 市场可能存在行业产能扩张规模过大导致竞争进一步加剧。

②劳动力和环保成本上涨

近年来，我国人口红利优势逐渐消失，劳动力供给日益紧张，我国劳动力成本逐渐上升，挤压 PCB 企业的利润空间。为缓解劳动成本上涨带来经营压力，部分企业逐步将生产基地转移至内陆地区。同时，严格的环保政策对 PCB 企业的成本管理和环保技术提出了新的要求。一方面环保要求的提升加大了企业新项目选址的难度；另一方面，环保成本的提高降低了项目的预期收益率。在双重成本压力的作用下，PCB 产业的落后产能将逐步被淘汰，未来几年行业的集中度将进一步提升。

3、行业主要壁垒

（1）技术壁垒

PCB 生产制造业属于技术密集型行业，对于产品生产过程中的工艺要求较高，存在较高的技术壁垒。不管是对于 PCB 产品的多样性、稳定性还是创新性都具有极高的技术要求。

首先，对于产品生产制造的多样性有较高要求。近年来 PCB 的生产工艺不断推陈出新，PCB 产品出于不同的材质和构造，种类较为多样化，并分别应对着不同的市场需求。不同种类的 PCB 产品所涉及到的专利技术、生产流程、技术关注点都不尽相同，通常需要结合下游客户的应用需求进行生产。因此 PCB 企业都会着重提高自身产品制造的多样性，掌握不同品类产品的核心技术，才能满足客户的各项需求，为客户提供高品质的产品和服务。

其次，对于产品生产制造的稳定性有较高要求。生产流程中的每一个环节都将影响到产品的质量，对于每个生产工序参数的设置要求都十分严格，客户对于产品的精密度要求也很高。因此想要持续保持高水准的生产制造水平，不仅需要原材料品质进行把控，更需要专业的制造设备和生产管理人员。

最后，对于产品生产制造的创新性有较高要求。从应用领域看，PCB 产品涉及到工业控制、汽车电子、交通、通信设备、医疗器械、光伏储能等领域。今后的应用领域还将继续扩大，且下游产品研发创新能力较强，产品更新换代较快。因此 PCB 企业的生产工艺水准、产品材料和结构都需保持较高的创新性，才能迎合下游行业不断创新变化的产品需求。

（2）客户壁垒

PCB 作为电子产品的重要元器件，其品质高低将直接影响下游行业电子产品质量，因此下游行业客户对于 PCB 供应商的选择认证都十分谨慎。下游客户通常结合自身的产品需求，对 PCB 企业的产品质量、技术水平、生产规模、产品交期、环保认证等诸多因素进行考量，一般会对 PCB 企业设置一定时间的考察期对 PCB 企业进行全方位考核。对于考核通过的 PCB 企业将会列入下游客户的合格供应商目录，双方展开长期稳定的合作，这对新进入 PCB 市场的制造企业产生较大的客户壁垒。对于小批量板行业而言，由于订单面积较小，企业想要扩大其公司规模，不能仅靠其产品质量，也需要较长时间的客户积累才能实现。公司凭借优秀的产品质量、先进的技术和高效的服务，积累了一定数量的客户资源，是企业长时间行业积淀的成果和业内声誉的体现，所形成的壁垒较难被打破。

（3）环保壁垒

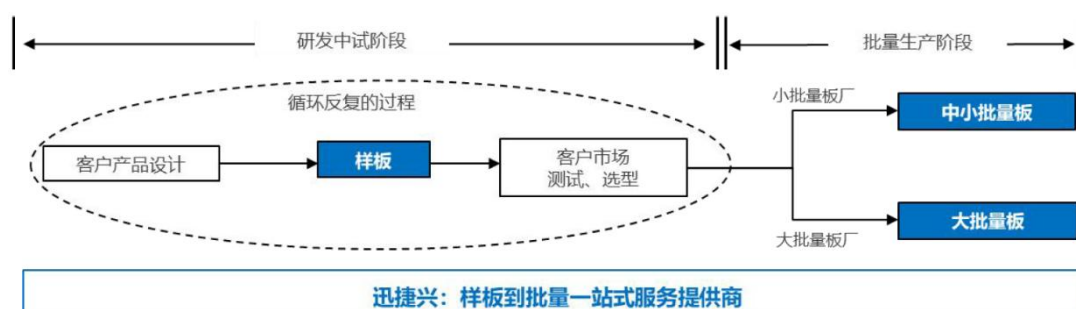
近年来，国内外对于环境保护的要求日趋严格，欧盟颁布了《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（RoHS）、《报废电子电气设备指令》（WEEE）、《化学品注册、评估、许可和限制》（REACH）等，2025 年欧盟 RoHS 指令进一步扩展了限制物质种类，REACH 高度关注物质清单亦持续更新。我国政府也逐步重视环境保护，发布了《电子信息产品污染控制管理办法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产标准—印制电路板制造业》《中华人民共和国环境保护税法》等一系列法律法规。2025 年我国发布了首个电器电子产品有害物质限制使用强制性国家标准，管控要求进一步升级。总体而言，要求 PCB 企业要清洁生产，不断改进生产工艺，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。因此为满足清洁生产的要求，

PCB 企业不仅需要不断改善环保处理工艺、加大环保设备的购置和运营投入，也需提升企业整体的环保意识和环保技术。

四、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）主营业务

公司主营业务为印制电路板的研发、生产与销售，致力于满足客户产品生命周期各阶段的需求，提供从样板生产到批量板生产的一站式服务，满足客户从新产品开发至最终定型量产的 PCB 需求。



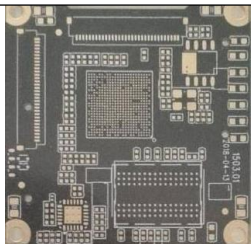
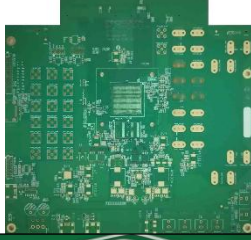
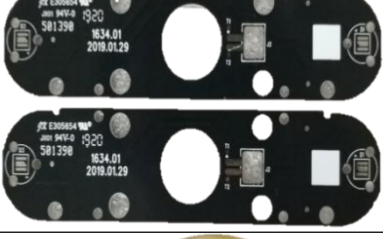
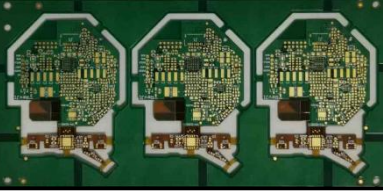
目前，国内 PCB 企业多以大批量业务为主，专注于样板业务的企业较少。公司业务涵盖样板、小批量板和大批量板，是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的 PCB 企业。

自成立以来，公司的主营业务没有发生变化。

（二）主要产品

公司主要产品为多品种的印制电路板，产品按导电图形层数可分为单面板、双面板和多层板。公司工艺技术全面，产品种类丰富，通过长期的产品研发和工艺技术积累，形成了多种特殊工艺和特殊基材的产品体系，可根据客户终端产品需求提供定制化的产品，产品类型覆盖刚性板、HDI 板、高频板、高速板、厚铜板、金属基板、挠性板、刚挠结合板等。

公司在特殊工艺、特殊基材方面的产品情况如下：

产品种类	产品特性	产品展示
HDI 板	是高密度互连（High Density Interconnect 印制电路板的简称，也称微孔板或积层板。HDI 是印制电路板技术的一种，可实现高密度布线，常用于制作高精密度电路板。HDI 板实现印制电路板高密度化、精细导线化、微小孔径化等特性。	
高频板	是指电磁频率较高的特种电路板，用于高频率与微波领域的 PCB，是在微波基材覆铜板上利用普通刚性线路板制造方法的部分工序或者采用特殊处理方法而生产的印制电路板，具有优良的电性能，良好的化学稳定性。	
高速板	是指由多层导电图形和低介电损耗的高速材料压制而成的印制电路板，高速板对信号完整性和电源完整性设计有较高的要求，可满足高速信号传输和转换的要求。	
厚铜板	是指任何一层铜厚为 30Z 及以上的印制电路板。厚铜板可以承载大电流和高电压，同时具有良好的散热性能。	
金属基板	是由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制电路板。金属基板具有散热性好、机械加工性能佳等特点。	
挠性板	是由柔性的绝缘基材制成的印制电路板。它可以自由弯曲、卷绕、折叠，可依照空间布局要求任意安排，并在三维空间任意移动和伸缩，从而达到元器件装配和导线连接一体化。	
刚挠结合板	是在一块印制电路板上包含一个或多个刚性区和挠性区，将薄层状的挠性板底层和刚性板底层结合层压而成。其优点是既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装需求。	

公司产品广泛应用于智能安防、汽车电子、工业控制、计算机与通信、智能消费设备、医疗器械、新能源（光伏储能）等领域。

1、智能安防领域

智能安防是对现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术和软件技术的综合利用，主要包含视频监控系统、侵犯报警系统、出入口门禁控制系统、防盗报警系统和可视对讲系统。公司产品主要应用于监控摄像头、热成像仪、人脸识别系统、数字视频录像机等。



2、汽车电子

汽车电子是电子信息技术与汽车传统技术的结合，随着消费者对于汽车功能性和安全性要求日益提高，推动了汽车电动化和智能化时代的到来。PCB 在汽车电子中的应用广泛，包括动力控制系统、安全控制系统、车身电子系统、娱乐通讯系统。由于汽车电子处于高温、大电流等工作环境特殊，对 PCB 的可靠性、环境适应性等要求非常严苛。出于对产品稳定性、安全性的考虑，汽车制造企业对供应商要求较高，认证周期较长，一般需要 2 至 3 年。公司产品主要应用于智能座舱、智能驾驶系统、自动驾驶雷达、智能影音系统、自动驾驶监控系统、尾气排放检测、智能导航及车联网、充电桩等。



3、工业控制领域

工业控制是指利用电子电气、机械、软件组合实现工业自动化，使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化，并具有可控性及可视性。公司产品主要应用于工业计算机、伺服器及机器人等领域，其中机器人领域，涵盖工业类焊接机器人、关节机器人、协作机器人、移动机器人，以及智能机器人关节、灵巧手、电机等。



4、计算机与通信领域

计算机与通信领域的 PCB 需求可分为计算机设备、通信设备及终端。其中，计算机设备主要包括服务器、存储设备等数据中心基础设施；通信设备主要指用于有线或无线网络传输的通信基础设施。随着 5G 技术的应用及算力需求的持

续提升，基站与数据中心硬件架构发生显著变化，对 PCB 提出了更高的技术要求。公司产品主要应用于算力与数据中心基础设施有关领域，涵盖连接器、光模块、存储、交换机、路由器、服务器电源等核心部件，还有通信领域射频天线、基站设备、有源相控阵雷达等关键设备。



5、智能消费设备领域

智能消费设备是对人工智能技术、物联网技术、传感器技术、无线通信技术等的综合利用，主要包含智能可穿戴设备、智能家居产品、智能影音设备、消费级智能机器人、智能出行设备等。公司产品主要应用于智能家居的扫地机器人等，智能穿戴的手表、AI 眼镜等，无人机、AI 全景相机等。



6、医疗器械

现代医疗器械产品逐渐呈现数字化和计算机化的特征，医疗电子在医疗器械产品中得到了广泛使用。出于对安全和有效的考虑，医疗器械行业对 PCB 的可靠性、安全性、环保性有较高的要求；医疗器械产品层级跨度大，包括消费类医疗产品，高可靠、高稳定的中高端医疗产品，高密度、高集成化的小型便携式产品，以及智能化、多功能的穿戴式医疗产品。公司产品主要应用于呼吸机、监护仪、血糖仪、血氧机、除颤仪、心电诊断仪器、影像诊断设备等。



7、光伏储能

光伏储能是对电力电子、电池管理、能量转换及智能监控等技术的综合利用，主要包含光伏组件、逆变器、储能电池系统、EMS 及 BMS 等。现代光伏储能系统呈现智能化、模块化特征，对 PCB 的耐高压、耐大电流、耐高低温及长寿命有较高要求；产品层级跨度大，覆盖户用消费级产品到工商业集中式逆变器。公司产品主要应用于光伏逆变器、光伏控制器、电池组、电池管理系统等。



（三）主要业务模式

1、销售模式

公司采取“向下游电子产品制造商直接销售为主、通过贸易商销售为辅”的销售模式。公司一般与主要客户签订框架性买卖合同，约定产品的质量标
准、交货方式、结算方式等；在合同期内，客户按需向公司发出具体采购订
单，并约定具体技术要求，销售价格、数量等。

目前公司以线下销售为主。2026 年 1 月，公司网上商城 www.wantpcb.com 上线运营，正式开启线上销售模式。客户可以通过公司网上商城实现“即时报
价、线上下单、自动审单、进度追踪”闭环，可极大提高样板订单服务体验。

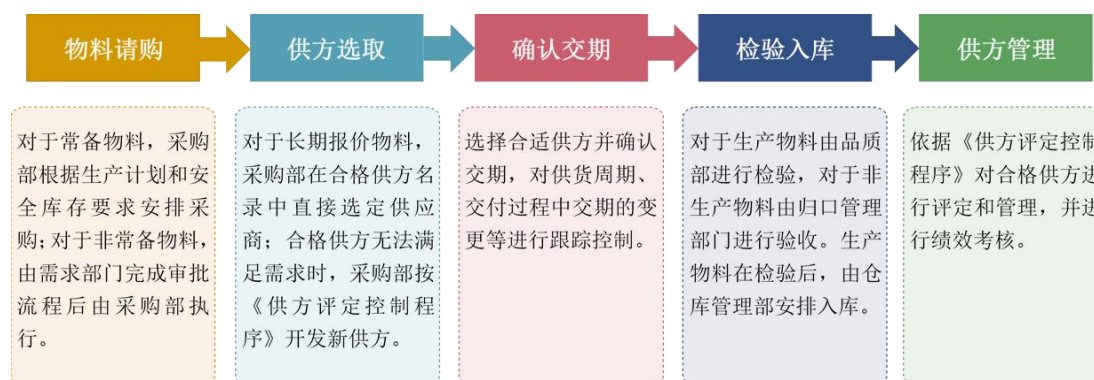
公司销售分为国内销售和出口销售。为了快速响应客户需求，公司国内销
售以直销为主，主要区域为华南和华东。公司出口销售通过日韩区、欧美区销
售团队扩增，进一步拓宽海外销售渠道，增加海外市场订单份额。

2、采购模式

公司产品涵盖 PCB 样板和批量板，生产所需原材料的规格、型号、品种较
多，因此公司原材料采购具有采购频率高、单次采购量小、品类多的特点。公
司主要原材料包括覆铜板、半固化片、金盐、铜箔、铜球、干膜、油墨等。通
常情况下，公司主要原材料向制造商直接采购，其他品种多、采购量小的辅材

则主要通过贸易商采购。对于常备物料，公司在保证安全库存的前提下，按生产计划安排采购；对于非常备物料，公司按实际生产需求安排采购。为保证原材料采购的品质、交期的稳定性，规避采购风险，公司制定了《供方评定控制程序》，对供应商的开发、管理、评审进行规范。

公司采购的流程如下图所示：



3、生产模式

公司产品涵盖 PCB 样板和批量板，可为客户提供从产品研发到批量生产一站式服务。PCB 样板和批量板均采用按订单生产的模式。其中 PCB 批量板针对的是新产品定型后的批量生产阶段，单个品种的需求量较大，生产主要体现为制板过程，定价依据主要体现为制板费。而 PCB 样板针对的是新产品定型前的研发、中试阶段，单个品种的需求量小，在线品种多，对公司柔性化生产管理能力要求较高。PCB 样板的生产过程既包括制板过程，也包括工程处理、模具制作等非制板过程。

营销中心在接到客户订单后，将客户技术文件交由工程部进行订单预审，识别常规订单和非常规订单。通常情况下，客户提供的设计文件需经公司工程技术人员审查、补正、优化，并转换成工程文件后，才可编制用于生产指导的制造说明。

计划部根据制造说明、出货需求、样品需求以及客户的交期，依据原材料库存情况、工序产量目标及生产周期一览表编制每日生产作业计划，并分发给工程部、物控部、品质部、生产部各工序。

生产部管理人员通过生产流程卡、作业指导书等内容得到拟生产产品的特性信息，并依照工艺流程、作业指导书等实施生产工艺排序和作业准备，同时

确保生产用原材料、辅料等器材与要求一致。

生产部根据生产排程表进行生产，并对生产过程进行记录，保证过程可追溯性。

4、研发模式

技术中心根据公司经营计划并结合行业前沿技术发展方向制订研发计划，经详细的技术、市场、产品等方面的调研后拟定研发项目。技术中心根据研发项目的难易程度，分步骤、分时段、分人员进行不同研发项目之间的统筹安排。研发项目实施过程中，技术中心对新工艺流程进行梳理并形成技术规范文件；研发项目结项通过后，公司及时启动专利申请对知识产权进行保护。

（四）与业务相关的主要固定资产和无形资产

1、固定资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司固定资产原值为 105,353.97 万元，账面价值为 73,795.79 万元，主要包括房屋及建筑物、机器设备等，具体情况如下：

单位：万元

类别	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	39,965.58	2,502.99	37,462.59	93.74%
机器设备	62,246.15	26,843.06	35,177.45	56.51%
运输设备	222.93	185.66	37.26	16.72%
电子设备及其他	2,919.31	2,026.46	1,118.49	38.31%
合计	105,353.97	31,558.18	73,795.79	70.05%

2、无形资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司无形资产原值为 3,131.12 万元，账面价值为 2,186.22 万元，主要包括土地使用权、软件等，具体情况如下：

单位：万元

类别	账面原值	累计摊销	账面价值	成新率
土地使用权	2,483.60	332.73	2,150.88	86.60%
软件	647.51	612.17	35.35	5.46%
合计	3,131.12	944.90	2,186.22	69.82%

五、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）现有业务发展安排

公司专注于 PCB 样板和小批量板业务，持续布局从客户产品研发到批量生产一站式服务模式。为匹配这一战略，公司各生产基地分工将更加明确，衔接更加紧密：深圳工厂将持续专注于量身定制的样板快件，沿高层、高速、高难度的产品路线发展，走特色化发展路线；信丰一厂定位于高多层、HDI 的中小批量产品生产；信丰二厂即信丰智能化工厂项目定位于批量产品的智能化生产；珠海工厂则结合互联网思维，打造智慧型标准化样板工厂等；通过三地联动，将公司打造为一个高效运营、资源共享、协同运作的集团化公司，为客户提供高附加值、高性价比、短交期的产品和服务体验。



公司将秉承“聚焦需求，实现客户最大利益，与时俱进，同协世界精工事业”的使命，奉行“诚信、务实、合作、共赢”的价值观，坚持“绿色经营、持续发展、追求创新、服务客户”的经营理念；坚持以市场为导向，持续跟踪下游客户应用需求以及行业发展趋势，力争在汽车电子、通信服务器/光模块、人工智能、光伏储能等重点应用领域取得技术创新和突破；坚持HDI、软硬结合板、金手指板等高端特殊工艺的发展路线，提高产品附加值，不断增强产品竞争力。

（二）公司发展计划

公司将聚焦市场、聚焦客户，发挥特色化一站式服务优势，加快推动产能的提升，加大市场开拓力度，提升服务水平，拓宽业务合作范围和深度，在品

质、价格、交期等方面多措并举提供富有竞争力的产品，以加速实现公司规模效应。

1、加速产能爬坡，以规模化生产驱动边际利润改善

2026 年公司拥有深圳、信丰和珠海三个生产基地，已筑牢规模化发展基础。伴随着市场复苏，公司将加快市场开发和优质大客户订单导入，从而加快提升现有工厂产能利用率水平，发挥规模效应，持续改善盈利水平。

（1）深圳基地：2026 年，深圳工厂将扎根于“多品种、小批量、高层次、短交期”的量身定制样板厂的定位，聚焦于通过提升工程新单制作能力提升产品平均单价，从而实现产能效益最大化，贡献稳定业绩；同时强化加急件 100% 准时交付保障，树立高品质快速打样良好口碑。

（2）信丰基地：2026 年，信丰工厂首要任务是以服务大客户为主，通过导入批量订单把产能填满，发挥规模效应。

（3）珠海基地：珠海一期智慧样板厂于 2025 年上半年投产，未来公司将根据产能爬坡进度，逐步将月产能提升至 6 万平方米，以实现样板规模化发展。该工厂兼具样板和批量板生产特性，致力于通过多个订单合并生产的样板批量化生产新模式，为客户提供品种多、品质高、交期短、价格优的高端样板服务。2026 年，公司将通过网上商城线上销售和与大客户建立研发样板订单战略合作加快导入样板和部分批量订单，以助力产能爬坡。同时，通过募投项目实施，聚焦 AI 核心赛道，将 HDI 发展为公司业绩增长的核心支柱产品。

2、积极布局高成长赛道，打造业绩增长新动能

人工智能产业的爆发式增长，为 PCB 企业带来结构性发展机遇。2026 年，公司重点聚焦 AI 应用领域，将增长动能明确锚定于 AI 算力产业链服务器 EDSFF 规格产品、连接器、光模块、AI 电源等，以及低轨卫星、低空经济、机器人等高成长赛道，深度绑定客户发展，提升市场份额。

同时，为适配高端 PCB 爆发式增长需求，助力公司业务拓展，公司还将加快优化现有产能结构，持续投入高端产能瓶颈设备，进一步扩充 HDI 产能，从而提升高附加值产品占比，提高产品毛利率水平，为未来业绩快速增长注入强劲动能。

3、加快高端产品技术研发，助力市场开拓

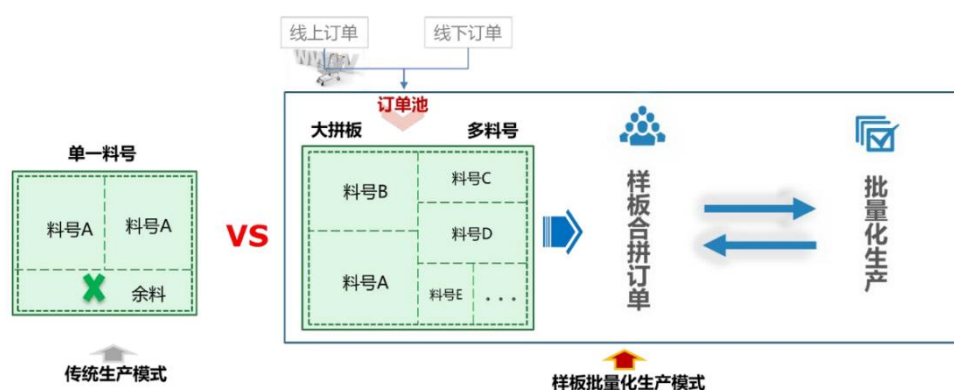
聚焦 AI 核心赛道，2026 年公司新产品研发将主要围绕高速光模块领域带埋铜块工艺的 800G/1.6T 光模块产品；AI 服务器相关领域 M8 等级高速材料的任意互联 HDI 产品、局部嵌入罗杰斯高频板产品、PTFE 高频材料与常规材料混压产品；厚铜电源板领域 120Z 超厚铜印制板、埋铜块 PCB 板、厚板厚铜多层电源板等产品开展技术开发工作。

公司围绕高速光模块、卫星通信、厚铜电源、高端消费电子、汽车电子等重点应用领域，开展新产品及 PCB 新工艺技术的研发工作，涵盖高多层、高密度互连（HDI）、软硬结合板及特种板等方向。

同时，技术中心将紧跟下游行业技术迭代节奏，提前布局下一代高速传输、服务器产品、低轨卫星、车载互联产品等，实现技术研发方向与市场实际需求的高效精准对接。

4、加速网上商城运营和推广，实现特色化发展

为充分发挥公司珠海智慧样板厂样板批量化生产模式的核心优势，精准对接市场上个性化、小批量、专业化的海量长尾订单需求，公司已正式上线运营 PCB 网上商城，实现 PCB 产品线上下单功能，有效拓宽了公司销售渠道。未来，公司将加速该网上商城的运营与推广，持续导入更多个性化、小批量订单，进一步提升样板合并效率，推动 PCB 业务实现特色化、规模化发展。



六、截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资的基本情况

（一）财务性投资及类金融业务投资的认定标准

1、财务性投资认定标准

根据中国证监会发布的《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第18号》”）第一条关于财务性投资的相关规定具体如下：

（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

（5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

（6）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

（7）发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。

2、类金融业务认定标准

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》第一条相关规定，除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。发行人应结合融资租赁、商业保理以及供应链金融的具体经营内容、服务对象、盈利来源，以及上述业务与公司主营业务或主要产品之间的关系，论证说明该业务是否有利于服务实体经济，是否属于行业发展所需或符合行业惯例。

（二）最近一期期末，公司不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情况

截至2026年6月30日，公司资产负债表中可能涉及财务性投资的主要科目包括货币资金、其他应收款、其他流动资产、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动资产，具体分析如下：

1、货币资金

截至2026年6月30日，公司货币资金情况如下：

单位：万元

项目	期末账面价值
库存现金	5.86
银行存款	9,033.99
其他货币资金	3,922.35
合计	12,962.20

截至2026年6月30日，公司其他货币资金主要为保证金等，不属于财务性投资。

2、其他应收款

截至2026年6月30日，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	期末账面价值
----	--------

项目	期末账面价值
应收利息	—
应收股利	—
其他应收款	301.69
合计	301.69

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他应收款主要为保证金和押金、预缴款项等，均不属于财务性投资。

3、其他流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	期末账面价值
留抵税额、待抵扣和待认证进项税	4,046.45
预缴企业所得税	21.19
合计	4,067.64

截至 2026 年 6 月 30 日，公司的其他流动资产主要为留抵税额、待抵扣和待认证进项税，均不属于财务性投资。

4、长期股权投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司长期股权投资情况如下：

单位：万元

项目	期末账面价值
深圳市骅富兴新能源科技有限公司	462.74
中山市新芮科技有限公司	252.32
合计	715.06

截至 2026 年 6 月 30 日，公司的长期股权投资主要为对骅富兴及中山新芮的长期股权投资。其中，骅富兴是太阳能光热系统、光伏发电系统、储能系统、充电桩系统的集成商及投资运营商，公司向骅富兴投资为财务性投资；中山新芮主要从事样品及小批量 SMT 业务，投资中山新芮是公司基于战略发展的需要，进一步完善上下游产业链，与公司现有业务形成互补，向中山新芮投资符合“围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资”，符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

5、其他权益工具投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他权益工具投资情况如下：

单位：万元

项目	期末账面价值
深圳市航盛电子股份有限公司	2,466.00
广东诺沛芯材有限公司	225.00
武汉云智光联科技有限公司	500.00
合计	3,191.00

截至 2026 年 6 月 30 日，公司的其他权益工具投资为对航盛电子、诺沛芯材和云智光联的投资，公司投资前述公司主要是出于产业战略考虑，具体分析如下：

航盛电子主营业务为汽车电子系列产品的研发、制造和销售，产品阵容覆盖智能座舱、智能驾驶、网联与软件服务系统、新能源汽车控制电子、汽车音响系统等产品，为客户提供全栈智能汽车解决方案。公司近年来大力发展汽车 PCB 业务，随着公司 HDI 及高频高速技术能力进一步提高，汽车电子自动驾驶域控制器、智能座舱域控制器、激光雷达等产品领域成为公司汽车电子产品核心业务。为进一步提升智能驾驶和智能座舱领域市场占有率，公司参股了航盛电子，以期抓住汽车产业发展更多机遇。

诺沛芯材是国内一家致力于国产化半导体先进封装、载板、类载板等高端材料及产业技术全方位解决方案的公司，公司参股诺沛芯材可实现双方深度合作，就诺沛芯材研发的 NPCF RCC 材料结合 FPS（细线路减法）工艺技术路线实施和导入，应用于高精密线路板生产，实现线宽/线距制造能力达到行业领先水平标准，并首先探索在 1.6T 光模块 PCB 使用等，为诺沛芯材关键材料广泛应用及助力公司技术能力提升实现互利共赢。

云智光联成立于 2025 年，是一家专注于 AI 光互联技术研发的高科技企业。核心业务为 OCS 光交换机设备及其核心器件的研发、生产和销售，并提供数据中心全光互联组网综合解决方案。参股云智光联有利于公司快速切入 AI 算力基础设施核心环节，抢抓行业高增长红利，是公司完善产业链布局的重要举措，符合公司长期战略发展方向。公司主营业务是 PCB 研发、生产和销售，产品可应用于数据中心、通信设备、AI 服务器等场景，OCS 交换机作为算力网络核心

终端，其 PCB 配套需求与公司主营业务和未来市场方向高度契合。

综上，公司前述投资行为符合“围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资”，符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

6、其他非流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	期末账面价值
预付房产、设备款、工程款和软件款	1,297.99
合计	1,297.99

截至 2026 年 6 月 30 日，公司的其他非流动资产为预付房产、设备款、工程款和软件款，不属于财务性投资。

综上所述，公司对骅富兴的股权投资，属于财务性投资，但其投资时间在本次董事会决议前 6 个月以外，且金额占归属于母公司净资产比例较小。截至 2026 年 6 月 30 日，发行人持有的财务性投资账面价值合计 462.74 万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为 0.69%。发行人最近一期末不存在金额较大的财务性投资，亦不存在类金融业务，也不存在募集资金直接或变相用于类金融业务的情况。

（三）自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，发行人实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况

本次发行董事会决议日为 2026 年 5 月 11 日，前六个月至本募集说明书签署日，发行人不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的情况。

七、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施

（一）公司科技创新水平

公司深耕 PCB 样板和小批量板行业多年，积累了丰富的多品种生产经验，形成了完善的技术体系。在公司发展历程中，累计服务了过万家客户，客户广泛分布于安防电子、通信设备、医疗器械、工业控制、汽车电子、轨道交通等领域。不同领域客户在产品需求、应用场景、性能要求等方面存在明显差异。

公司在服务客户的过程中不断总结提炼，在高多层、高精密、特种板及特殊工艺要求等方面积累了丰富的技术经验，形成了独特的技术优势，并在综合应用工艺技术的基础上，为客户提供更具个性化的优质服务。

公司拥有一支理念先进、技术全面、能力突出、实践经验丰富的技术中心团队，服务于公司新产品的开发和工艺技术的研究，以及为客户提供定制化的工程解决方案。公司及子公司信丰迅捷兴均为国家高新技术企业，并分别挂牌成立了广东省高精密精细印制线路板工程技术研究中心、赣州市 HDI（线路板）工程技术研究中心。

经过多年的发展，公司积累了包括光模块板生产技术、多种镀厚金板生产工艺技术、盲埋孔板（HDI）生产技术、厚铜电源板生产技术、高频板、高速板生产技术、服务器板生产技术、高精密多层板生产技术、毫米波雷达板生产技术等多项 PCB 生产核心技术，在印制电路板生产过程中起到了改进工艺流程、提高生产效率、降低制造成本、优化技术参数等作用，同时能够更好地满足客户对产品质量、技术性能等方面的要求。公司拥有的核心技术均为自主创新，多项核心技术处于行业或国内先进水平，并已全面应用在各主要产品的设计当中，实现研发成果的有效转化。

（二）保持科技创新能力的机制或措施

1、构建技术研发团队和管理体系

公司始终将工艺技术研究与新产品开发作为公司发展的重要支撑。经过二十余年的发展，公司已构建成三百余人的技术团队，并形成了一套切实有效的技术研发管理体系。

2、完善人才选拔、员工培训和晋升体系

公司持续建设人才选拔体系，从岗位需求出发，恪守人才标准，关注人才质量，通过社会招聘、校园招聘、校企合作、猎头推荐、员工推荐、内部招聘与培养等多样化的渠道与方式，吸引、选拔、聘用高素质人才，确保人才认同企业价值观并具备持续发展潜力。公司高度关注行业内新工艺新技术的研究进展与发展方向，对于与公司战略目标相匹配的高端人才，采用灵活的市场化招聘方式大力引进。

公司注重员工素质和职业技能的提升。对于新引进的毕业生，公司制定了全方位的培训计划，包括入职培训、综合素质培训、行业基本知识培训、公司产品和技术实战培训等；对于内部选拔员工和社招员工，公司侧重其专业能力的提升，鼓励员工参与在职远程教育、提升学历、参加国家职称考试等。公司建立了共享知识和共同成长的学习交流平台，依托信息化系统搭建知识平台供员工学习和交流，以会议的形式组织员工进行知识分享和交流。

公司为员工提供科学合理的晋升通道和适合其自身特点的职业发展路径。公司从员工工作年限、技术水平、工作业绩、培养潜力等多个维度评估员工发展潜力和发展方向，并制定差异化的晋升和发展路径。“因材施教”的方式，发挥了每一位员工的潜力，培养了专业化、富有创造力的队伍，为保持公司的核心竞争力奠定了人才基础。

3、建立鼓励员工自主创新的激励机制

为激励员工自主创新，尤其是在新技术、新工艺方面的研究和开发，公司制定了相关激励制度鼓励员工参与各类专利的申请，对成功申请各类专利的员工按贡献程度给予不同金额的奖励。同时，公司推行全面业绩激励制度，将业绩考核指标与科技创新紧密联系，鼓励各部门组织技术创新活动，以保持公司技术创新活力。

4、建立完整的知识产权管理体系

公司高度重视知识产权的保护和技术失密风险的控制，制定了完整的知识产权管理体系，对知识产权的获取、维护、运用、保护等方面进行了严格规范。对于设计、生产、研发过程中产生的技术成果，公司及时申请专利进行保护。

八、同业竞争情况

（一）发行人是否存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业从事相同、相似业务的情况

公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售。公司控股股东、实际控制人为马卓。截至报告期末，除发行人及其控股子公司外，发行人控股股东、实际控制人马卓控制的其他企业为捷兴投资、迅兴投资，捷兴投资、迅兴投资

系发行人的员工持股平台，未经营与发行人相同或相类似业务，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在重大不利影响的同业竞争情况。

（二）避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人马卓出具了《关于避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，具体内容如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或经营实体，未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务，本人与公司不存在同业竞争；

2、自本承诺函出具日始，本人承诺自身不会、并保证将促使本人控制（包括直接控制和间接控制）的除公司及其控股子公司以外的其他经营实体（以下简称“其他经营实体”）不开展与公司相同或类似的业务，不新设或收购从事与公司相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；

3、本人将不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东合法权益的经营活动；

4、本人其他经营实体高级管理人员将不兼任公司之高级管理人员；

5、无论是由本人或本人其他经营实体自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利；

6、本人或本人其他经营实体如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他经营实体在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件；

7、若发生本承诺函第 5、6 项所述情况，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他经营实体尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务

的情况以书面形式通知公司，并尽快提供公司合理要求的资料，公司可在接到本人或本人其他经营实体通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权；

8、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他经营实体将不与公司拓展后的产品或业务相竞争，可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的，本人自身、并保证将促使本人其他经营实体将按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到公司经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他有利于维护公司权益的方式；

9、本人确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；

10、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；

11、如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；

12、本承诺函自本人签署之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在本人作为公司控股股东/实际控制人期间及自本人不再为公司控股股东/实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。

截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人严格履行承诺，未出现同业竞争情形。

第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、PCB 行业市场前景广阔

在全球电子元器件各细分领域中，PCB 占据产值规模最大的地位。近年来，电子信息产业的持续繁荣带动了 PCB 市场容量的不断扩张。据 Prismark 统计，2025 年全球 PCB 产业产值达到 858.36 亿美元，较上年同期增长 16.7%；预计到 2030 年，全球市场规模将进一步攀升至 1,446.10 亿美元，2025 至 2030 年间复合年增长率约为 11.0%。其中，中国大陆 PCB 产业 2025 年产值增速达 20.9%，未来五年（2025—2030）复合增长率预计为 10.5%，全球第一大 PCB 生产基地的地位有望进一步巩固。从中长期视角看，行业整体仍将保持稳健的增长态势。

2、国家产业政策持续出台，科技创新倒逼 PCB 产业发展

PCB 作为电子元器件的支撑载体，承担着电气连接与信号中继传输的核心功能，是各类电子产品不可或缺的基础互连件。“十四五”以来，《“十四五”规划纲要》《“十四五”数字经济发展规划》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等政策文件相继发布，明确将人工智能列为新兴数字产业的培育重点，要求提升通信设备、核心电子元器件等关键产业水平，加快构建自主可控的电子信息产业链生态，为 PCB 产业向高端化升级营造了有利的政策环境。

2025 年 10 月发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称“十五五规划建议”），进一步将科技创新置于战略核心位置，提出以高水平科技自立自强引领新质生产力发展，围绕集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域推进全链条关键核心技术攻关；同时要求优化提升传统产业，培育壮大新兴产业和未来产业，推动科技创新与产业创新深度融合。针对下游应用端，“十五五规划建议”明确要加快新能源、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，推进人工智能等数智技术迭代升级，并前瞻布局脑机接口、具身智能、第六代移动通信等未来产业。

被誉为“电子产品之母”的 PCB，其应用领域已深度渗透至集成电路、人

工智能、移动通信、新能源、航空航天、低空经济等战略性新兴产业及未来产业集群。提升 PCB 产业创新体系的整体效能，不仅是新质生产力落地的重要支撑，亦是巩固壮大实体经济根基的关键环节。

3、AI 产业快速崛起，推动 HDI 板市场快速扩容

2024 年以来，人工智能产业进入爆发式增长阶段，国内核心产业规模突破 5,000 亿元。生成式 AI 的广泛应用对数据处理和传输性能提出了更高要求，直接拉动算力基础设施加速建设，为 PCB 行业开辟了新的增长空间。根据 IDC 发布的《全球人工智能支出指南》预计，到 2027 年中国人工智能总投资规模将突破 400 亿美元，复合增长率为 25.6%，其中人工智能硬件在预测期内仍将成为市场投资最主要的方向，占比超中国市场总规模的 60%。

算力基础设施的规模化扩张，叠加 AI 服务器、高性能计算设备及网络通信设备更新周期的启动，共同推动 HDI 板等中高端 PCB 需求快速放量。据行业研究机构预测，至 2029 年 HDI 板市场规模将达到 212.95 亿美元，2024 至 2029 年复合增长率为 11.2%，显著高于行业整体增速，景气度持续上行。

顺应下游应用的技术演进，PCB 产品正加速向高速、高频、高集成、轻薄化方向迭代。与传统 PCB 相比，人工智能用高端 PCB 在层间对准精度、基材介电性能、信号完整性及长期可靠性等方面的技术门槛显著抬升。随着算力基建投入持续加大，掌握 HDI 核心技术储备的企业有望获得更大的市场空间，竞争优势将进一步凸显。

（二）本次发行的目的

1、优化产能结构与产品布局，抢抓新兴领域发展机遇

近年来，以人工智能、低空经济、新能源、光模块为代表的新质生产力加速发展，推动 PCB 产品从传统的电气互连基础件向高速、高频、高集成的系统级结构件升级，行业迎来质价重估的价值跃迁窗口。公司虽已掌握高密度 HDI 互联等多项核心技术，但现有产能结构仍以安防电子、汽车电子及工业控制领域产品为主，中高端产能储备已难以匹配下游快速增长的需求。本次募集资金拟投向 HDI 等高端产品领域，通过引进大批量自动化生产设备，突破相关产品产能瓶颈，在巩固既有优势的同时，加快切入 AI 服务器、高速光模块、高端通

信设备等新兴赛道，实现产品结构升级与经营规模扩张的良性互动，全面提升公司技术层级与市场竞争力。

2、深化新兴领域客户拓展，构建多元化增长格局

公司产品广泛应用于安防电子、通信设备、医疗器械、工业控制、汽车电子、轨道交通等多个领域，目前致力于承接更多服务器光模块、智能硬件、通信类等高端 PCB 产品，积极拓展 AI 服务器连接器、光模块等产品领域。AI 服务器、高速光模块及高端通信设备市场正处于爆发增长期，下游龙头客户采购规模大、合作周期长，且普遍采用深度绑定的供应链合作模式，一旦进入核心供应商体系，订单粘性与份额稳定性显著优于传统领域。本次募投项目聚焦于 HDI 板等高端产能建设，旨在为公司切入 AI 服务器、高速光模块、智能硬件等前沿赛道提供充足的产能支撑与工艺保障。通过本次募投实施，公司将在巩固原有优势领域的基础上，进一步拓宽下游应用边界，丰富产品与客户结构，培育 AI 算力及通信设备等新的业绩增长点，形成传统优势业务与新兴高增长领域协同发展的多极增长格局，增强公司整体抗风险能力与持续成长动能。

3、充实资本实力与优化财务结构，筑牢长期发展根基

PCB 行业具有显著的技术密集与资本密集特征，高端产能建设、前沿工艺研发及新兴市场开拓均需要长期、大量的资金投入。当前公司正处于业务结构优化与战略转型的关键阶段，随着 HDI 等高端产品占比提升，公司在技术研发、设备更新、人才引进及市场拓展等方面的资金需求日益凸显。本次发行所募资金将有效充实公司资本实力，提升总资产与净资产规模，优化资产负债结构，降低财务杠杆。募投项目建成达产后，预计将带来新的收入和利润增量，改善公司资产收益率与现金流状况。此外，高端 PCB 产品市场需求明确、附加值较高，且具备较强的抗周期属性，能够在一定程度上对冲传统领域市场波动的影响，提升公司整体经营韧性与风险抵御能力，为公司中长期发展战略的全面实施提供坚实的资金保障。

随着电子产业的迭代加速，PCB 产值稳步增长，该行业具有广阔的市场空间和良好的发展前景。面对 PCB 行业良好的发展前景，国内的 PCB 厂商积极参与竞争，在质量、交期、规模等方面充分竞争。公司将使用本次以简易程序向

特定对象发行 A 股股票募集资金进一步扩大产能，抓住发展机会，提升公司的综合竞争力和影响力。

二、发行对象与发行人的关系

本次发行的发行对象为郭伟松、财通基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、华安证券资产管理有限公司、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 16 号私募股权投资基金、诺德基金管理有限公司。上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）本次发行证券的价格或定价方式

本次以简易程序向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2026 年 8 月 17 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的发行底价将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ，两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利 D，每股送红股或转增股本数为 N。

同时为高效、有序地完成本次发行工作，董事会同意在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长或其授权人士与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。公司和主承销商

有权按照经公司董事长或其授权人士调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以启动追加认购或中止发行等相关程序。

公司根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 37.61 元/股。

（二）发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 3,456,527 股，未超过发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

本次发行的发行对象具体获配情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）
1	郭伟松	797,660	29,999,992.60
2	财通基金管理有限公司	654,081	24,599,986.41
3	大家资产管理有限责任公司	638,130	24,000,069.30
4	华安证券资产管理有限公司	606,221	22,799,971.81
5	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 16 号私募股权投资基金	396,171	14,899,991.31
6	诺德基金管理有限公司	364,264	13,699,969.04
合计		3,456,527	129,999,980.47

（三）限售期安排

本次发行的股票自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

四、募集资金数额及用途

本次发行股票募集资金总额不超过人民币 13,000.00 万元。在扣除本次发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入
1	珠海迅捷兴 HDI 产线建设项目	14,545.80	9,500.00
2	补充流动资金	3,500.00	3,500.00
合计		18,045.80	13,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，则在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

若本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

五、本次发行是否构成关联交易

本次发行的发行对象为郭伟松、财通基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、华安证券资产管理有限公司、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 16 号私募股权投资基金、诺德基金管理有限公司。上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至本募集说明书签署日，公司的控股股东、实际控制人为马卓先生。马卓先生直接持有公司 5,157.31 万股股份，持股比例为 38.66%；通过捷兴投资、迅兴投资分别间接持有公司 72.80 万股股份、31.88 万股股份，持股比例分别为 0.55%、0.24%，合计持有公司 5,261.99 万股股份，持股比例为 39.45%。本次发行完成后，公司股本将相应增加，马卓持有股份占公司总股本的比例将有

所下降。因本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件

本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

（一）已履行的批准程序

1、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项已经 2025 年年度股东会授权；

2、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司于 2026 年 5 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过；

3、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项修订稿已经公司于 2026 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过；

4、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项二次修订稿已经公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。

（二）尚需履行的批准程序

1、本次以简易程序向特定对象发行股票尚需经上海证券交易所审核通过；

2、本次以简易程序向特定对象发行股票尚需经中国证监会作出同意注册的决定。

九、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件的说明

（一）本次发行符合《公司法》规定的发行条件

1、本次发行符合《公司法》第一百四十三条的相关规定：股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支

付相同价额。

2、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，发行价格不低于票面金额。本次发行符合《公司法》第一百四十八条的相关规定：面额股股票的发行价格可以按票面金额，也可以超过票面金额，但不得低于票面金额。

3、根据发行人于2026年4月17日召开的2025年年度股东会作出的决议，发行人股东会已授权董事会决定发行人本次以简易程序向特定对象发行股票涉及的股票种类及数额、发行价格、发行有效期、发行对象等，符合《公司法》第一百五十一条的规定。

（二）本次发行符合《证券法》规定的发行条件

1、公司本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》第九条规定。

2、公司本次发行将根据《注册管理办法》等法律法规的相关规定，经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复，符合《证券法》第十二条第二款“上市公司发行新股，应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，具体管理办法由国务院证券监督管理机构规定”。

（三）本次发行符合《注册管理办法》规定的条件

1、公司不存在《注册管理办法》第十一条不得向特定对象发行股票的情形

（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；

（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

（3）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

（4）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

(5) 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

(6) 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

2、公司符合《注册管理办法》第十二条的规定

(1) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

(2) 除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

(3) 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；

(4) 科创板上市公司发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。

3、本次发行符合《注册管理办法》第十八条、第二十一条及第二十八条关于适用简易程序的规定

根据发行人于 2026 年 4 月 17 日召开的 2025 年年度股东会作出的决议，发行人股东会授权发行人董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，授权期限自发行人 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

发行人第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议以及第四届董事会第十二次会议审议通过了本次发行有关的议案。本次发行适用简易程序符合《注册管理办法》第十八条、第二十一条及第二十八条的规定。

4、本次发行的发行对象及人数符合《注册管理办法》第五十五条、第五十八条的规定

本次发行的发行对象为郭伟松、财通基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、华安证券资产管理有限公司、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 16 号私募股权投资基金、诺德基金管理有限公司。本次发

行对象未超过 35 名，发行对象及人数符合《注册管理办法》第五十五条、第五十八条的规定。

5、本次发行的发行价格符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条的规定

本次发行的定价基准日为发行期首日（2026 年 8 月 17 日），发行价格为 37.61 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。本次发行的发行价格符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条的规定。

6、本次发行的锁定期安排符合《注册管理办法》第五十九条的规定

本次发行完成后，发行对象认购的发行股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，本次发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，锁定期届满后按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、行政规章、规范性文件、交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定执行。本次发行的锁定期安排符合《注册管理办法》第五十九条的规定。

7、本次发行符合《注册管理办法》第六十六条的规定

发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形，符合《注册管理办法》第六十六条规定。

综上所述，发行人本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件。

（四）本次发行符合《审核规则》的相关规定

1、本次发行符合《审核规则》第三十四条的规定

发行人本次发行不存在《审核规则》第三十四条规定的下列不得适用简易程序的情形：

- （1）上市公司股票被实施退市风险警示或者其他风险警示；

(2) 上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚、最近一年受到中国证监会行政监管措施或者证券交易所纪律处分；

(3) 本次发行上市申请的保荐人或者保荐代表人、证券服务机构或者相关签字人员最近一年因同类业务受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分。在各类行政许可事项中提供服务的行为按照同类业务处理，在非行政许可事项中提供服务的行为，不视为同类业务。

2、本次发行符合《审核规则》第三十五条的规定

发行人及保荐人提交申请文件的时间在发行人年度股东会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内。

发行人及其保荐人提交的申请文件包括：

(1) 募集说明书、发行保荐书、审计报告、法律意见书、股东会决议、经股东会授权的董事会决议等申请文件；

(2) 上市保荐书；

(3) 与发行对象签订的附生效条件股份认购合同；

(4) 中国证监会或者上交所要求的其他文件。

综上所述，发行人本次发行符合《审核规则》规定的发行条件及适用简易程序的条件。

(五) 本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定

1、公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资；

2、公司及控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公众利益的重大违法行为；

3、本次拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%；

4、上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月；前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少

于六个月；前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定；

5、本次发行股票募集资金主要投向主业，本次发行属于理性融资，融资规模具有合理性；

6、本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的 30%。

（六）本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定

本次发行不存在“7-1 类金融业务监管要求”的相关情形：

“1、除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

2、发行人应披露募集资金未直接或变相用于类金融业务的情况。对于虽包括类金融业务，但类金融业务收入、利润占比均低于 30%，且符合下列条件后可推进审核工作：

（1）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入类金融业务的金额（包含增资、借款等各种形式的资金投入）应从本次募集资金总额中扣除。

（2）公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。

3、与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。发行人应结合融资租赁、商业保理以及供应链金融的具体经营内容、服务对象、盈利来源，以及上述业务与公司主营业务或主要产品之间的关系，论证说明该业务是否有利于服务实体经济，是否属于行业发展所需或符合行业惯例。

4、保荐机构应就发行人最近一年一期类金融业务的内容、模式、规模等基本情况及相关风险、债务偿付能力及经营合规性进行核查并发表明确意见，律

师应就发行人最近一年一期类金融业务的经营合规性进行核查并发表明确意见。”

经核查，发行人不存在从事类金融业务的情形，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前不存在新投入和拟投入类金融业务的情形；发行人不存在将募集资金直接或变相用于类金融业务的情形；发行人及其子公司不存在从事与主营业务相关的类金融业务的情形；发行人最近一年一期不存在从事类金融业务的情形。

（七）本次发行符合《承销细则》的相关规定

1、本次发行符合《承销细则》第五十条的相关规定

本次发行适用简易程序，未由董事会决议确定具体发行对象，由发行人和主承销商在召开董事会前向符合条件的发行对象提供认购邀请书，以竞价方式确定发行价格和发行对象。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为37.61元/股，确定本次发行的对象为郭伟松、财通基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、华安证券资产管理有限公司、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增16号私募股权投资基金、诺德基金管理有限公司。发行人已与确定的发行对象签订了附生效条件的股份认购协议，并在认购协议中约定，本次发行一经股东会授权的董事会批准并经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后，该协议即生效。

综上，本次发行符合《承销细则》第五十条的相关规定。

2、本次发行符合《承销细则》第五十三条的相关规定

本次发行适用简易程序，发行人与发行对象于2026年8月21日签订股份认购合同后，发行人年度股东会授权的董事会于2026年8月24日召开第四届董事会第十二次会议，确认了本次发行的竞价结果等相关发行事项。

综上，本次发行符合《承销细则》第五十三条的相关规定。

（八）本次发行不会导致发行人控制权的变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件

根据本次发行竞价情况，本次发行的股票数量为 3,456,527 股，不超过本次发行前公司股份总数的 30%。本次发行完成后，马卓仍为公司的实际控制人。

本次发行完成后，公司社会公众股占总股本的比例仍超过 25%。综上，本次发行不会导致发行人控制权的变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

（九）本次证券发行满足“两符合”和不涉及“四重大”相关规定

1、满足“两符合”的相关规定

（1）本次发行符合国家产业政策

公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，是电子信息产业中活跃且不可或缺的重要组成部分。公司 PCB 产品类型丰富，覆盖刚性板、HDI 板、高频板、高速板、厚铜板、金属基板、挠性板、刚挠结合板等品类，满足下游领域对 PCB 的各种需求。产品广泛应用于工业控制、汽车电子、通信设备、医疗器械、新能源、消费电子等领域。根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C398 电子元件及电子专用材料制造”之“C3982 电子电路制造”。

PCB 行业得到了国家相关产业政策的大力支持，我国先后通过出台《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》等政策方针，把 PCB 行业相关产品列为重点发展对象。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2024 年本），“新型电子元器件制造：高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板、高密度高细线路（线宽/线距 $\leq 0.05\text{mm}$ ）柔性电路板等”被列为“鼓励类”发展产业。

公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后，募集资金净额将用于“珠海迅捷兴 HDI 产线建设项目”及补充流动资金，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。

(2) 本次发行符合板块定位（募集资金主要投向主业）

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 13,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于“珠海迅捷兴 HDI 产线建设项目”及补充流动资金。公司本次募集资金投向围绕公司 PCB 主业进行布局，旨在增加公司 HDI 板产能。

本次募投项目围绕公司 PCB 主营业务展开，募集资金不存在投向非主营业务的情形。

2、不涉及“四重大”的情形

公司主营业务及本次发行募投项目不涉及情况特殊、复杂敏感、审慎论证的事项；公司本次发行不存在重大无先例事项；不存在影响本次发行的重大舆情；不存在相关投诉举报、信访等重大违法违规线索，本次证券发行符合《监管规则适用指引——发行类第 8 号》的相关规定。

综上所述，公司本次发行满足“两符合”的相关规定，不涉及“四重大”的相关情形。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 13,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入
1	珠海迅捷兴 HDI 产线建设项目	14,545.80	9,500.00
2	补充流动资金	3,500.00	3,500.00
合计		18,045.80	13,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，则在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）珠海迅捷兴 HDI 产线建设项目

1、项目基本情况

类别	内容
项目名称	珠海迅捷兴 HDI 产线建设项目
实施主体	珠海市迅捷兴电路科技有限公司
项目总投资	14,545.80 万元
项目建设内容	在珠海迅捷兴进行 HDI 产线建设，扩大应用于服务器、光模块、网络通信等算力基础设施领域的高密度互连（HDI）印制电路板生产规模
建设地点	珠海市富山工业园规划医药路东侧、规划产城中路北侧

2、项目实施的必要性

（1）顺应 PCB 行业高端化趋势，抢占核心增长赛道

当前，全球 PCB 产业正由规模扩张向结构优化转型，低端产品需求趋弱，高端化进程持续加速，其中 HDI 板已成为引领行业增长的核心品类，而 UHD I（超高密度互连）作为 HDI 技术的高阶演进形态，更是全球 PCB 行业中长期确

定性较高的发展方向。对公司而言，加快布局 HDI 板等高端产品，是实现增长曲线跃升的战略支点，也是在本轮产业变革中巩固竞争根基的必由之路。

从行业数据来看，高端 PCB 赛道景气度显著。据 Prismark 统计，2025 年 HDI 板产值同比增幅为 29.4%，为 PCB 细分领域中增速领先的品类；中长期看，2025-2030 年其复合增长率预计达 13.1%，高端化发展趋势明确。

从需求端看，高端 PCB 的增长逻辑清晰、动能充足。AI 算力基础设施、高速网络通信等新质生产力领域持续放量，构成高端 PCB 需求扩张的关键支撑。AI 服务器及配套 EDSFF 存储设备的规模化部署需要高密度、高功率、高可靠的硬件架构升级，对 PCB 的层数、材料及精密加工工艺提出更高要求，直接推动行业向高密度化、高集成化演进；以 800G/1.6T 高速光模块为代表的超高速光通信设备，对 PCB 的线宽线距、阻抗控制及信号完整性提出严苛要求，驱动 PCB 制造向超高密度互连、高频高速方向升级。

（2）突破高端产品工艺壁垒，构建长期核心竞争力

HDI 板，尤其是应用于服务器、光模块等领域的高端产品，其制造工艺复杂，是融合材料学、精密加工、信号完整性设计等多学科的系统工程。

从工艺要求来看，HDI 板技术壁垒集中于“微盲孔/埋孔高密度互连”，通过微孔技术替代传统通孔提升布线密度，高阶 HDI 需循环层压、激光钻孔、微孔电镀等工序，工艺难度随阶数呈指数级上升。传统减成法受侧蚀问题限制，难以实现 15 μm 以下稳定量产，无法匹配下一代高速光模块需求。

本次募投项目采用的先进技术，可将线宽线距公差控制在更小范围，实现微米级精细线路加工、精密孔径控制与高平面度管控，不仅能满足当下下游对高阶 HDI 的需求，其核心工艺能力也可迭代至 UHDI 技术标准，逐步攻克超细线路、超小微孔、超薄介质层等 UHDI 核心工艺难点，推动公司技术能力实现从高阶 HDI 到 UHDI 的跨越式升级，从而构建起公司的核心竞争力。

（3）依托 AI 算力产业机遇，打开高价值增长空间

当前，生成式 AI 驱动的科技革命正重塑全球算力基础设施格局，为上游 PCB 供应商打开了结构性、高附加值的增量窗口。公司布局 HDI 板，意在推动客户结构从安防、工业控制等传统优势领域，向 AI 算力等前沿赛道延伸，抢占

产业升级红利。

AI 服务器高速传输依赖高性能连接器，AI 集群向万卡/十万卡升级带动高速连接器速率向 112Gbps、448Gbps 迭代，叠加 EDSFF 规格产品规模化应用，直接拉动高端 PCB 需求升级。EDSFF 企业级存储凭借高存储密度、强散热能力及对 PCIe Gen5/6 协议的适配性，加速替代传统存储方案，成为高端 SSD 与服务器硬件主流形态，直接带动 PCB 需求结构性升级。与此同时，1.6T 光模块的规模化商用对 PCB 提出了全新的技术需求。光模块从 800G 向 1.6T 升级，要求 PCB 具备更高的讯号完整性、更精细的线路及更高的散热能力，这直接推动了新技术在 PCB 板级的应用。

布局 AI 服务器与高速光模块赛道，企业既要有规模化高端产能，也要拥有通过客户认证的稳定制程体系。本次募投项目将提升公司生产批量高阶 HDI 板的能力，补齐高端产品批量交付与超细线路加工短板，助力公司成长为该领域的核心供应商。

（4）契合国家产业战略导向，助力高端制造与产业链自主可控

公司募投项目的战略定位与国家推动制造业高端化、智能化发展的方向高度一致，充分响应了增强产业链供应链自主可控能力的政策导向。

HDI 板是电子信息产业不可或缺的基础核心部件，其技术水准直接关系到 5G 通信、人工智能、数据中心、网络通信等战略性新兴产业的发展质量与安全韧性。当前，全球高端 PCB 产能呈现高度集中态势，主要分布在中国台湾、日本、韩国等地区的少数领先厂商。中国大陆 PCB 产业虽已实现规模全球第一，但在高端产品领域仍存在明显短板，中低端占比偏高。加速本土 PCB 企业向高阶 HDI 等高端赛道突破，是夯实电子信息产业根基、实现科技自立自强的重要战略支点。

（5）满足高端产能建设资本需求，保障设备升级与先进产能落地

高端 PCB 制造是典型的技术密集型和资本密集型行业。从普通多层板向高阶 HDI 跃迁，需投入重金新建或改造厂房，并购置系列专用生产设备，本次募集资金是确保这一资本开支顺利落地的关键保障。

设备投资是高端 PCB 产能建设中占比最高的支出项目。以高阶 HDI 板为例，

随着层数增加、阶数提升及材料迭代，钻孔效率明显降低，同等产出规模下设备需求量上升，且对高精度钻孔机的依赖加剧。若完全依赖经营积累滚动投入，现金流将被严重拖累，更可能因产能建设周期过长而错失市场爆发的时间窗口。借助资本市场进行股权融资，既能缓解短期财务压力，又能加速长期战略落地，是快速构建先进产能、抢占市场先机的最优路径。

3、本次募集资金投资项目的可行性

（1）核心技术积累深厚，支撑高端产能工艺升级

自成立以来，公司发展战略始终聚焦于样板、小批量，致力于为客户提供从样品研发到中试再到量产的一站式服务，在技术领域形成了深厚的积累，这为其向更高层次的 HDI 板业务拓展提供了坚实的技术支撑。

从研发体系与成果来看，公司已建立起成熟的创新机制，并获得了权威认可。公司是国家高新技术企业，深耕 PCB 样板和小批量板行业多年，形成了完善的技术体系。公司已完成任意互联 HDI 结构的 800G 光模块 PCB、1.6T 光模块 PCB 技术研发，不断丰富 10G-1.6T 光模块产品技术积累，为公司积极拓展光模块市场打下了基础。公司拥有的核心技术均为自主创新，多项核心技术处于行业或国内先进水平，并已全面应用在各主要产品的设计当中，实现研发成果的有效转化，能够为高端产品的持续开发提供体系化的技术保障。

从数字化制造基础及经验来看，公司已在珠海工厂及信丰二厂打造了 PCB 数字化智能工厂，数字化智能工厂利用 ERP、MES、EAP、WMS、APS、SCM 及企业跨系统集成平台 ESB 系统集成大数据管理，通过工厂自动化设备互联互通，实现工厂全流程管理的数字化和透明化。公司未来拟将成熟数字化制造经验平移至本项目进行应用。

（2）一站式服务优势、头部客户资源、互联网接单端口构成强大市场准入壁垒

公司一站式服务优势、头部客户资源、互联网接单端口构成了公司进军 HDI 板市场坚实的护城河和可行性保障。

首先，国内 PCB 市场格局呈现“大批量主导、样板稀缺”的特征，能够实现从样板到批量一站式延伸的企业屈指可数。公司已构建样板、小批量板、大

批量板协同发展的业务体系：对大批量企业而言，公司的样板业务是前置获客的独特优势，可更早触达客户研发需求；对样板或小批量企业而言，公司的大批量产能是一站式服务的核心支撑，确保客户产品定型后产能无缝切换。

其次，公司战略性聚焦智能安防、工业控制、汽车电子、人工智能等高景气赛道，围绕大客户及潜在大客户展开深度运营，通过审厂、复审等机制加速订单转化，实现样板到批量的量质齐升。核心客户矩阵包括海康威视、大华股份、NCAB GROUP、视源电子、Würth（伍尔特）、北斗星通、道通科技、锐明技术、富鼎精密、迈瑞医疗等国内外知名企业，为公司长期稳健发展提供有力保障。

最后，互联网在线接单平台为市场拓展提供流量入口。公司推出电子商务平台，实现 PCB 生产在线询价、DFM 可制造性分析、在线下单、款项支付、订单管理及进度查询、在线售后服务等功能，有效覆盖和满足市场容量广阔的长尾需求。互联网在线接单平台为行业内为数不多的品牌在线接单平台，为公司及产品知名度的积累与提升提供了良好助益。在本项目未来投产后，互联网在线接单平台亦可以为本项目相关产品提供线上订单支持。

（3）专业人才体系完善，保障项目高效落地

多年经营积累使公司形成了一支稳定、专业且具备深厚行业积淀的管理团队。核心员工长期在 PCB 企业从事生产、技术、销售、管理工作，对电路板制造工艺及品质管理理念有深刻把握，熟悉客户内部流程与管理范式，能够开展精准高效的沟通协作。公司注重人员结构稳定，并通过股权激励机制持续强化人才吸引力与绑定度，提升员工对公司的认同感与归属感。

公司工程自动化系统的搭建在减少公司对工程技术人员依赖的同时，可极大提高 PCB 制程效率、精度和可靠性，降低制造成本，提升产品竞争力。工程自动化系统可实现自动报价、自动预审、自动 EQ、CAM 文件自动处理、智能合并、生产资料自动生成等功能，使订单快速进入生产排产环节。工程自动化系统的搭建和使用经验未来可以在本项目中进行有效复制及利用。

（4）下游需求高速增长，支撑新增产能消化

市场需求方面，AI 服务器单台存储容量可达通用服务器的 3 倍以上，带动

EDSFF 产品需求持续攀升。据 Prismark 统计，2025 年 EDSFF 带动 PCB 需求超 18 亿美元，同比增长 70%，预计 2029 年需求将达 65 亿美元，2025 至 2029 年复合增速预计达 36%，显著高于行业增速。

光模块承担着算力信号高速传输的核心功能，其市场需求随 AI 算力密度提升呈现快速增长态势。从市场规模来看，据 LightCounting 等预测，2025 年全球光模块市场规模超 230 亿美元，同比增长 50%，其中 800G/1.6T 高速光模块成为增长重心。2026 年全球光模块市场规模预计达 180-300 亿美元，同比增长 35%-43%，且 1.6T 光模块已进入量产元年，2026 年出货量预计突破 2000 万只，硅光方案占比达 80%。从需求驱动来看，AI 训练组网架构升级、海外科技巨头加大 AI 投入，叠加 CPO 产业加速落地，持续放大光模块需求，下一代超高速光模块对 PCB 的信号完整性、布线密度提出极致要求，UHDI 产品将成为该领域主流方案，持续拉动常规 HDI 向超高密度超细线路升级迭代，其规模化应用直接带动高频高速 PCB 需求扩容，为 PCB 行业带来显著增量。

4、项目投资概算

本项目总投资金额为 14,545.80 万元，本次拟使用募集资金投入 9,500.00 万元，项目投资结构如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	设备购置及安装费用	14,159.80	97.35%
2	建筑工程费用	386.00	2.65%
合计		14,545.80	100.00%

5、项目涉及土地、备案、环评审批情况

本项目建设地点位于珠海市富山工业园规划医药路东侧、规划产城中路北侧，公司已取得该处国有土地使用权。截至本募集说明书签署日，本项目的备案手续已办理完成；本项目无需重新办理环境影响评价手续。

6、项目经济效益分析

经测算，本项目税后静态投资回收期为 7.71 年（含建设期），税后内部收益率为 12.34%。效益预测的假设条件及计算过程如下：

（1）营业收入测算

本次测算采用单价参考公司 2025 年 AI 服务器、光模块领域 HDI 板产品平均单价确定，同时谨慎预估价格下降，假设 2028-2030 年每年售价降幅 5%，预估价格乘以销量合计为本项目营业收入，预计达产年销售收入为 19,494.00 万元。

（2）成本测算

本项目生产成本主要为直接材料费、直接人工成本和制造费用，直接材料费用参照同类产品成本数据估算确定，直接人工成本由定员人数及预计平均工资确定。制造费用由生产管理人员成本、折旧摊销、燃料及动力费构成。

（3）期间费用测算

本项目期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用。本项目的生产模式、管理运营模式与研发模式与公司现有情况相类似，因此本项目管理费用率及研发费用率的测算参考公司历史平均费用率的水平确定。

（4）税金测算

项目相关税费主要包含增值税、所得税和城市维护建设税等，相关税负按照税收法律法规的有关规定测算。

（二）补充流动资金

1、项目基本情况

公司计划将本次募集资金中的 3,500.00 万元用于补充流动资金，以优化公司财务结构，从而提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。

2、项目的必要性

从行业发展趋势与竞争格局变化来看，公司业务规模近年来不断扩大，未来几年仍处于成长阶段，生产经营、市场开拓、研发投入等日常运营对营运资金的需求显著增加。本次发行募集资金用于补充流动资金，可在一定程度上匹配业务扩张节奏，缓解资金压力，优化财务结构，提升抗风险能力与整体竞争实力。

3、项目的可行性

（1）本次发行募集资金使用符合相关法律法规的规定

本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金用于补充流动资金，符合现行法律法规及监管要求，方案切实可行。募集资金到位后，将有效改善公司资本结构，降低财务风险；面对日益激烈的行业竞争，营运资金的补充能够缓解业务拓展带来的资金压力，为公司持续、健康、快速发展提供保障，符合公司及全体股东的根本利益。

（2）公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系

公司依据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规范运作要求，构建了完善的公司治理体系，建立健全了各项规章制度和内部控制制度，并在生产经营实践中持续改进和优化。公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批程序、使用方向、日常管理及监督机制予以明确规范。

三、募集资金用于扩大既有业务的情况

公司主营业务为印制电路板的研发、生产与销售，产品类型覆盖刚性板、HDI 板、高频板、高速板、厚铜板、金属基板、挠性板、刚挠结合板等。公司业务涵盖样板、小批量板和大批量板，是行业内为数不多可以提供从样板到批量生产一站式服务的 PCB 企业。

本次募投项目为 HDI 产线建设，依托公司多年来积累的光模块板生产技术、多种镀厚金板生产工艺技术、盲埋孔板（HDI）生产技术、厚铜电源板生产技术、高频板、高速板生产技术、服务器板生产技术等多项 PCB 生产核心技术，公司聚焦 AI 算力产业链核心客户，加快高阶 HDI、厚铜电源板等能力提升，积极拓展高速光模块、算力硬件市场。

本次募投项目与公司当前主营业务方向相符合，有利于公司巩固行业地位，进一步提升公司的技术水平和服务能力，从而进一步增强公司的盈利能力和核心竞争力，符合公司战略发展目标。

四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

（一）实施能力

针对本次募投项目，公司在人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备，

公司具备募投项目的综合执行能力。相关情况如下：

1、人员储备

公司始终将工艺技术研究与新产品开发作为公司发展的重要支撑。经过二十余年的发展，公司已构建成四百余人的技术团队，并形成了一套切实有效的技术研发管理体系。此外，公司持续建设人才选拔体系，从岗位需求出发，恪守人才标准，关注人才质量，大力引进和培养高素质科技人才，为公司募集资金投资项目的顺利实施奠定了基础。

2、技术储备

公司经过多年在 PCB 领域的积累，拥有一批经验丰富、技术过硬的骨干人员和一套完善的研发体系。近年来，公司紧跟 PCB 行业技术升级的步伐，不断加大研发投入，报告期内的研发费用分别为 3,249.04 万元、3,213.67 万元、3,892.98 万元和 2,232.01 万元。公司已经为本次募集资金投资项目的实施进行了充分的技术储备。

3、市场储备

受益于公司在 PCB 样板、小批量板领域多年的深耕，公司累计服务了过万家企业，在安防电子、通信设备、医疗器械、工业控制、汽车电子、轨道交通等领域积累了丰富的产品技术经验和大客户资源，为后续公司进一步发展提供了更广阔的市场空间，报告期，公司聚焦 AI 算力产业链核心客户，加快高阶 HDI、厚铜电源板等能力提升，其中公司完成任意互联 HDI 结构的 800G 光模块 PCB、1.6T 光模块 PCB 技术研发，不断丰富 10G-1.6T 光模块产品技术积累，为公司积极拓展光模块市场打下了基础。

（二）资金缺口的解决方式

本次募投项目总投资额为 18,045.80 万元，拟使用募集资金投资金额为 13,000.00 万元。本次募集资金到位后，公司根据制定的募集资金投资计划具体实施。在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。

五、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

本次募集资金投资项目为珠海迅捷兴 HDI 产线建设项目及补充流动资金项目，资金投向围绕主营业务进行。公司主营业务为印制电路板的研发、生产与销售。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1. 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”，符合国家战略及政策重点支持发展的科技创新领域。

（二）募投项目将促进公司科技创新水平的提升

1、突破高端产品产能瓶颈，优化产品结构布局

当前公司 HDI 板等高端产品产能相对有限，难以充分满足下游客户日益增长的研发创新与批量交付需求。通过本次募投项目建设，公司将系统性扩充高阶 HDI 板生产能力，引进适配高端制程的先进设备，完善全流程工艺体系。项目投产后，公司高端产品产能将得到显著释放，有效缓解当前高阶产品产能不足的瓶颈约束，推动公司产品结构向更高技术含量、更高附加值的 HDI 板领域加速升级。

2、对接下游高端应用需求，驱动核心技术持续迭代

随着下游通信、汽车电子、人工智能及高性能计算等领域技术迭代加快，市场对 HDI 板的集成密度、信号传输性能及可靠性要求持续提升。募投项目建成后，公司将更好地满足下游行业龙头客户对高端产品的技术要求。通过深度嵌入下游高端应用的创新链条，公司将不断推动 HDI 高密度互连技术等核心工艺的创新迭代，形成需求牵引与技术突破的良性互动。

3、提升高端产品工艺水平，增强中高端市场竞争力

近年来，全球 PCB 产业中高端产能持续向中国大陆转移，高阶 HDI 板市场份额加速向具备先进制程能力与稳定交付水平的优势企业集中。本次募投项目通过继续扩大 HDI 板等高端产品产能、提升技术水平，将显著提升公司高端产品的工艺稳定性与批量交付能力，进一步推动公司生产及技术能力完成质的飞

跃，从而构建起公司的核心竞争力。项目建成后，公司承接高阶 HDI 板订单的能力将大幅增强，有助于公司积极拓展国内外中高端客户群体，提升在高端 PCB 市场的竞争地位。

六、本次募集资金用于研发投入的情况

本次募集资金投资项目除补充流动资金外为“珠海迅捷兴 HDI 产线建设项目”，暂无将募集资金用于研发投入的情况。

七、发行人主营业务及本次募投项目不涉及产能过剩行业，限制类、淘汰类行业，高耗能高排放行业

发行人主营业务及本次募投项目的主要产品为印制电路板，符合国家产业政策鼓励方向，受到国家产业政策鼓励和支持。

发行人主营业务及本次募投项目不涉及《国务院关于加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）、《关于印发〈淘汰落后产能工作考核实施方案〉的通知》（工信部联产业〔2011〕46号）、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）、《2015年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》（工业和信息化部、国家能源局公告2016年第50号）、《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业〔2017〕30号）、《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2020〕901号）等文件中列示的产能过剩行业，不涉及《产业结构调整指导目录（2024年本）》所规定的限制类及淘汰类行业，不涉及《国家发展改革委办公厅关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》《关于加强应对气候变化统计工作的意见的通知》《关于印发〈环境保护综合名录（2021年版）〉的通知》等文件中规定的高耗能、高排放行业。

综上，发行人主营业务及本次募投项目不涉及产能过剩行业，限制类、淘汰类行业，高耗能高排放行业，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。

八、本次募集资金投资项目可行性分析结论

公司本次以简易程序向特定对象发行股票投资项目符合国家产业政策和法

律法规的规定，符合公司所处行业现状和未来发展趋势，符合公司整体发展战略规划。本次募集资金投资项目具备良好的市场发展前景和经济效益，募集资金投资项目的实施有利于增强公司的长期盈利能力，改善公司财务结构，充实公司资金实力，提升公司可持续发展能力，进一步回报投资者。

综上所述，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目具备必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益。

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划

公司的主营业务为印制电路板的研发、生产和销售。公司本次发行募集资金围绕主营业务展开，其中珠海迅捷兴 HDI 产线建设项目是公司顺应产业发展趋势、响应下游客户需求、优化公司产品结构做出的重要布局，符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向，有利于进一步提升公司盈利能力，增强公司市场竞争力，促进公司可持续发展。同时，部分募集资金用于补充流动资金将进一步增强公司资金实力，优化资本结构，为经营活动的高效开展提供有力支持。

本次发行完成后，公司的主营业务范围不会产生重大变化，公司亦暂无业务及资产整合计划。

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行不会导致本公司的控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布仍符合上市条件。

三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

四、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

本次发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人不存在关联交易情况。

五、本次发行完成后，公司科研创新能力的变化

公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目的实施，将有效满足公司业务发展的需要，有利于增强公司资本实力，有助于公司提升科研创新能力，增强公司整体运营效率，促进业务整合与协同效应，从而提升公司盈利能力和综合竞争力。

第五节 最近五年内募集资金运用的基本情况

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

按前次募集资金到账时间计算，最近五年内，公司进行过一次募集资金行为，具体如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕961号）同意注册，公司2021年4月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3339万股，发行价为7.59元/股，募集资金总额为人民币25,343.01万元，扣除各项发行费用人民币5,337.49万元，实际募集资金净额为人民币20,005.52万元。该次募集资金到账时间为2021年4月30日，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月30日出具天职业字[2021]21256号验资报告。

二、前次募集资金基本情况

截至2026年6月30日，公司募集资金已按规定用途全部使用完毕，公司全部募集资金专户已注销。前次募集资金在专项账户中的具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账户	账户类别	初始存放金额	2026年6月30日余额	备注
招商银行股份有限公司沙井支行	755917304810828	募集资金专户	7,505.52	-	已注销
中国银行股份有限公司深圳新沙支行	753674742360	募集资金专户	9,500.00	-	已注销
杭州银行股份有限公司深圳龙华支行	4403040160000336590	募集资金专户	3,000.00	-	已注销
招商银行股份有限公司沙井支行	755933502310828	募集资金专户	-	-	已注销
合计	——	——	20,005.52	-	

前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额：			25,343.01			已累计使用募集资金总额：			20,968.02	
募集资金净额：			20,005.52			各年度使用募集资金总额：			15,096.30	
变更用途的募集资金总额			20,005.52			2023 年度			8,313.23	
变更用途的募集资金比例			100.00%			2024 年度			5,681.80	
						2025 年度			1,101.27	
						2026 年 1-6 月			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	年产 30 万平方米高多层板及 18 万平方米 HDI 板项目	年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目	37,500.00	20,005.52	20,968.02	37,500.00	20,005.52	20,968.02	962.50	2023 年 10 月
2	补充流动资金		7,500.00							不适用
合计	——	——	45,000.00	20,005.52	20,968.02	37,500.00	20,005.52	20,968.02	962.50	——

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额主要为募投资金存放在银行的利息收益及理财收益。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

发行人前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预期效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-6 月		
1	年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目	50.19%	本项目投产后可新增年产能 60 万平方米，达产后预计年均税后净利润可达到 5,036.82 万元。	-786.69	1,008.39	1,618.32	747.35	2,587.37	否

注：受市场竞争加剧，项目产能利用率未达最优状态等因素影响，导致项目实际效益不及预期。

四、前次募集资金投资项目变更情况

（一）原募集资金投资项目

经第二届董事会第十八次会议审议，同意公司将首次公开发行募集资金净额20,005.52万元全部投入“年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目”，不足部分由公司自筹资金解决，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	拟投资总额	拟投入募集资金
1	年产 30 万平方米高多层板及 18 万平方米 HDI 板项目	37,538.13	20,005.52
2	补充流动资金	7,500.00	-
合计		45,038.13	20,005.52

（二）变更后募集资金投资项目

公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，并于2021年9月15日经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，同意公司将原募集资金投资项目由“年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI项目”变更为“年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目”。变更后项目如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	拟投资总额	拟投入募集资金
1	年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目	32,314.07	20,005.52
合计		32,314.07	20,005.52

（三）变更募集资金投资项目的原因

本次募集资金用途变更，主要是公司现有产能已无法满足订单快速增长的需要，为加快产能扩建，满足客户订单增长需求，同时加快向智能制造转型升级。变更后募投项目的厂房已于2020年底竣工并交付使用，将有利于加快扩大公司的产能和提高短期内业务承接能力，更好地发挥公司规模效应，同时，其将利用MES平台集成大数据管理，采用“双辅料+大拼版”的生产方式等构建智能化工厂，从而进一步提高产线的自动化水平，降低生产成本、提高经营效率，助力公司快速步入发展快车道赶超同行。

关于变更募集资金投资项目具体内容可详见于公司2021年8月31日于上海证

券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-018）。

（四）变更后募投项目延期的情况

公司于2022年6月24日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于募投项目延期的议案》。

1、募投项目延期的具体情况

公司变更后募投项目因无需新建厂房，原计划项目建设期约1年，分二期投入；在募投项目实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，募投项目投产时间调整如下：

项目第一期开始投产时间由2022年6月延长至2022年12月，投产产能仍为25,000m²/月；

项目第二期投产时间由2022年第四季度延期至2023年10月，投产后募投项目年产能可达60万m²。

2、募投项目延期的原因

项目未按原计划进行投产主要原因如下：

一是2022年面对复杂严峻的国内外形势等诸多因素冲击，部分供应商生产进度受到影响，使得公司部分关键设备未按原计划时间到厂，导致项目实施进度较原计划有所滞后；公司结合实际情况，充分考虑设备到厂安装调试时间等项目实施进度后，将该项目开始投产时间进行调整。

二是受外部经济环境和市场需求波动的影响，经审慎考虑，公司拟将主要以填补瓶颈工序以扩充产能为目的的项目第二期设备预投时间规划进行调整，实现投产时间由2022年第四季度调整至2023年10月。

关于募投项目延期的具体内容可详见于2022年6月25日于上海证券交易所网站披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-030）。

五、闲置募集资金的使用情况

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年5月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议同意公司使用不超过人民币3,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2022年8月31日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年8月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年4月26日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自2024年5月27日起至2024年年度董事会召开日止，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用等。

（二）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年5月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2022年5月16日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第

十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2022年5月27日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

2023年5月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自2023年5月27日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

2024年4月26日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自2024年5月27日起至2024年年度董事会召开日止，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用等。

六、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用

前次募集资金投资项目为年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目，与公司现有主营业务密切相关，公司主营业务为印制电路板的研发、生产与销售。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1. 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”，符合国家战略及政策重点支持发展的科技创新领域。前次募集资金投资项目的实施有利于进一步提升公司研发能力和科技创新水平，推进产品迭代和技术创新，升级和完善产品体系，促进主营业务发展，巩固并提升公司核心竞争力和市场占有率。

七、会计师事务所出具的专项报告结论

华兴会计师事务所对《深圳市迅捷兴科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》执行了鉴证工作，并出具了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（华兴专字[2026]26006290057号），发表意见为：“迅捷兴公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券

监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面如实反映了迅捷兴公司截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况。”

第六节 与本次发行相关的风险因素

投资者在评价发行人本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下述风险因素。

一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素

（一）市场和经营风险

1、行业周期波动风险

印制电路板作为电子元器件基础行业，其景气程度与宏观经济及电子信息产业的整体发展状况存在较为紧密的联系。宏观经济波动对 PCB 下游行业将产生不同程度的影响，进而影响 PCB 行业的需求增长。目前，我国已逐渐成为全球印制电路板的主要生产基地，同时国内印制电路板行业受全球经济环境变化的影响日趋明显。根据 Prismark 统计，2023 年全球 PCB 产值同比下降 15%至 695.17 亿美元，行业周期下行波动导致 PCB 生产行业内部竞争加剧。2024 年全球 PCB 总产值达 735.65 亿美元，同比增长 5.8%，PCB 行业迎来结构性复苏。2025 年，全球 PCB 市场增长进一步提速，全球 PCB 产业产值同比增长 16.7%，产值达到约 858.36 亿美元。

全球经济形势依然复杂多变，对于 PCB 行业依然面临着价格竞争加剧、原材料涨价等严峻挑战。若未来宏观经济出现明显回落或下游行业出现更大的不利因素，PCB 产业的发展速度可能持续出现放缓或下降，从而对公司的盈利情况造成不利影响。

2、行业产能大幅扩张导致产品价格下降的风险

近年来，全球 PCB 产能不断向国内聚集，我国已逐渐成为全球印刷线路板的主要生产基地。近几年国内 PCB 产能仍处于快速扩张态势，若未来出现行业产能过剩、行业竞争加剧导致产品价格下滑，公司未能持续提高公司的技术水平、生产管理、产品质量以应对市场竞争，则存在盈利下滑的风险。

3、市场竞争风险

PCB 行业竞争激烈，行业格局正朝着“大型化、集中化”方向发展。行业龙头企业通过技术创新、规模扩张及供应链整合不断增强市场影响力，而中小企业则面临更大生存压力。若公司未能及时把握市场机遇，持续进行资金投入及技术研发，快速适应产品开发和市场策略的变化，可能会在市场竞争中失去优势，出现订单下滑、收入利润下降进而导致市场份额缩减的风险。

4、经营业绩亏损风险

报告期内，公司实现营业收入 46,411.80 万元、47,458.50 万元、68,913.22 万元和 51,879.54 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 1,346.97 万元、-197.40 万元、-2,237.90 万元和 1,426.35 万元。最近两年净利润为负，主要系公司仍然处于产能爬坡阶段，人工、折旧等固定成本未被摊薄，叠加原材料价格上涨，导致公司毛利偏低；同时公司处于业务拓展期，各项期间费用不同程度增加，叠加资产及信用减值损失增加等多重因素综合影响。从中长期来看，全球 PCB 行业仍呈现增长趋势。然而，若公司未能通过加快市场开拓等提高产能利用率，公司业绩将可能继续亏损。

5、管理风险

近年来，发行人经营规模和资产规模持续扩大，该状况对发行人的管理能力提出了更高的要求。虽然发行人已制定了一整套成熟的管理制度，培养了一批经验丰富的管理人员和业务人员，但公司组织架构、管理体系将随着公司资产规模的扩大和新的募投项目的实施更趋于复杂，如果公司在管理水平、内控制度建设方面未能相应提升，将可能面临由于迅速扩张引致的管理风险。

（二）财务风险

1、毛利率下降的风险

报告期，公司主营业务毛利率分别为 15.14%、14.33%、8.52%和 10.43%，整体呈下降趋势。尽管公司毛利率水平处于同行业合理区间，且公司每年投入大量的研发费用来对产品进行优化升级，但若未来行业竞争加剧导致产品销售价格下降，而公司未能及时通过提升订单和产品结构有效参与市场竞争；或者原材料价格上升，而公司未能有效控制产品成本等情况发生，公司毛利率将存在下降的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

2、应收票据及应收账款无法收回的风险

公司根据客户的历史交易记录和销售规模，给予客户一定的货款结算周期。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 13,811.73 万元、13,837.49 万元、21,528.03 万元和 29,569.65 万元，公司应收票据账面价值分别为 4,623.12 万元、3,061.90 万元、4,176.90 万元和 4,785.76 万元，应收账款和应收票据合计占各期流动资产的比例分别为 41.84%、42.64%、46.03%和 47.56%。公司的应收票据、应收账款占公司流动资产的比例较大。未来随着公司经营规模的扩大，应收账款余额和应收票据将随之增长。如果主要客户的财务状况突然出现恶化，将会给公司带来应收票据、应收账款无法及时收回的风险。

3、存货减值风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 4,085.82 万元、4,826.56 万元、9,687.49 万元和 15,620.46 万元，占当期流动资产的比例分别为 9.27%、12.18%、17.35%和 21.62%，金额占比迅速提升。随着市场价格的波动，公司存在存货跌价损失加大的风险。

4、高新技术企业税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司享受高新技术企业所得税的税收优惠和研发费用加计扣除。如果中国有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得中国高新技术企业资格或不满足研发费用加计扣除的条件等，将对公司的经营业绩造成一定影响。

二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素

（一）审批风险

本次发行尚需经上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册的决定。本次发行能否获得上交所审核通过或中国证监会同意注册，以及最终取得审核通过或同意注册的时间，均存在不确定性。

（二）发行风险

由于本次发行为向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集资金，投资者的认购意向以及认购能力受到证券市场整体情况、二级市场公司股票价格

走势、投资者对本次发行方案的认可程度以及市场资金面情况等多种内外部因素的影响。

此外，不排除因市场环境变化、根据相关规定或监管要求而修改方案等因素的影响，导致原股份认购合同无法顺利履行的可能，本次发行方案可能因此变更或终止。因此，本次发行存在募集资金不足乃至发行失败的风险。

（三）股票价格波动风险

公司股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家的经济政策、经济周期、通货膨胀、国内外政治经济局势、资本市场走势、投资者心理预期、重大自然灾害及其他重大突发事件等多种因素的影响。因此，公司的股票价格存在若干不确定性，并可能因上述风险因素出现波动，直接或间接地给投资者带来投资收益不确定性的风险。

三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素

（一）募投项目实施风险

公司本次发行募投项目与公司发展战略密切相关。虽然公司对募集资金投资项目在建设规模、产品方案及技术方案等方面进行了充分的可行性分析，但如果出现行业政策调控、当地政府宏观调控、项目实施组织管理不力等情况，募集资金投资项目在实施进度、实施效果等方面存在一定不确定性。

（二）募投项目效益未达预期的风险

公司本次募投项目效益测算系基于公司历史实际经营情况和未来行业发展状况所作出的预测，未来是否与预期一致存在不确定性。虽然公司对项目的可行性作出了充分论证、对经济效益测算进行了审慎分析，但如果未来印刷电路板市场环境出现重大变化，竞争格局、市场需求、产品价格、原材料成本等方面出现重大不利变化，则公司可能面临募投项目效益不及预期的风险。

（三）产能无法消化风险

公司本次募集资金投资项目涉及的相关产品产能设计主要结合公司对上述产品未来的市场需求规模、公司预期可能实现的市场占有率等因素综合确定。

公司光模块领域新增客户目前大多处于测试阶段，如公司未来产品市场开拓进展不及预期，新客户导入量产的转换率低，或现有产品的市场份额未继续提升甚至下滑，则可能导致公司本次募集资金投资项目的新增产能无法得到较好利用，进而对项目的预期收益带来不利影响。

（四）募投项目新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险

本次募投项目建成后，每年将会产生一定的固定资产折旧摊销费用。尽管公司对募投项目进行了充分论证和可行性分析，但上述募投项目收益受宏观经济、产业政策、市场环境、竞争情况、技术进步等多方面因素影响，若未来募投项目的效益实现情况不达预期，募投项目新增的折旧摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响。

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：



马 卓



杜 勇

李 铁

洪 芳



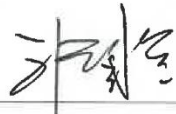
马 颖

刘木勇

非董事高级管理人员：



吴玉梅



刘望兰



2026 年 9 月 8 日

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

 _____ 马 卓	 _____ 李 铁	_____ 马 颖
_____ 杜 勇	_____ 洪 芳	_____ 刘木勇

非董事高级管理人员：

_____ 吴玉梅	_____ 刘望兰
--------------	--------------

深圳市迅捷兴科技股份有限公司



2026 年 9 月 8 日

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

马 卓

李 铁

马 颖



杜 勇

洪 芳

刘木勇

非董事高级管理人员：

吴玉梅

刘望兰

深圳市迅捷兴科技股份有限公司



2026 年 9 月 8 日

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

马 卓

李 铁

马 颖

杜 勇

洪 芳

刘木勇

非董事高级管理人员：

吴玉梅

刘望兰

深圳市迅捷兴科技股份有限公司



2026 年 9 月 8 日

发行人审计委员会声明

公司审计委员会承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

审计委员会成员：



杜 勇

洪 芳

刘木勇

深圳市迅捷兴科技股份有限公司



2026 年 9 月 8 日

发行人审计委员会声明

公司审计委员会承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

审计委员会成员：

杜 勇

洪 芳

刘木勇

深圳市迅捷兴科技股份有限公司



2026 年 9 月 8 日

发行人审计委员会声明

公司审计委员会承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

审计委员会成员：

杜 勇

洪 芳


刘木勇

深圳市迅捷兴科技股份有限公司


2026 年 9 月 8 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人：

马 卓

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2026年9月9日

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人： 薛熠凡
薛熠凡

保荐代表人： 蔡宇宁
蔡宇宁

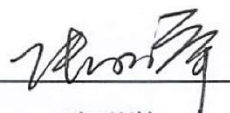
张腾夫
张腾夫

法定代表人： 徐春
徐 春

国联民生证券承销保荐有限公司
2026年9月8日

保荐人董事长和总经理声明

本人已认真阅读深圳市迅捷兴科技股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理： 
张明举

董事长： 
徐 春



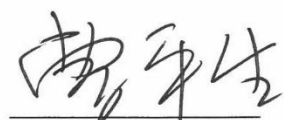
四、发行人律师声明

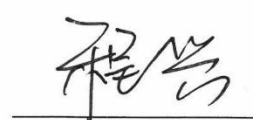
本所及经办律师已阅读《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

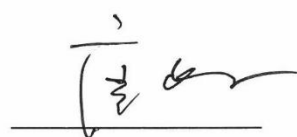
律师事务所负责人：


李 忠

经办律师：


曹平生


程 兴


廖 敏



2026年9月8日

五、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告、内部控制审计报告、前次募集资金使用情况鉴证报告以及非经常性损益的鉴证报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的上述文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



童益恭

签字注册会计师：



徐继宏



郑晓鑫

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）



2026 年 9 月 8 日

六、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺：深圳市迅捷兴科技股份有限公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

全体董事：



马 卓



杜 勇

李 铁

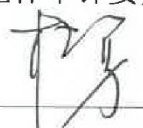
洪 芳



马 颖

刘木勇

全体审计委员会成员：

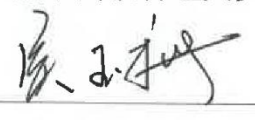


杜 勇

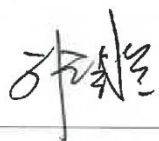
洪 芳

刘木勇

非董事高级管理人员：



吴玉梅



刘望兰

深圳市迅捷兴科技股份有限公司



六、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺：深圳市迅捷兴科技股份有限公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

全体董事：

 _____ 马 卓	 _____ 李 铁	_____ 马 颖
_____ 杜 勇	_____ 洪 芳	_____ 刘木勇

全体审计委员会成员：

_____ 杜 勇	_____ 洪 芳	_____ 刘木勇
--------------	--------------	--------------

非董事高级管理人员：

_____ 吴玉梅	_____ 刘望兰
--------------	--------------

深圳市迅捷兴科技股份有限公司



2026 年 9 月 8 日

六、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺：深圳市迅捷兴科技股份有限公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

全体董事：

马 卓

李 铁

马 颖



杜 勇

洪 芳

刘木勇

全体审计委员会成员：

杜 勇

洪 芳

刘木勇

非董事高级管理人员：

吴玉梅

刘望兰

深圳市迅捷兴科技股份有限公司



2026年9月8日

六、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺：深圳市迅捷兴科技股份有限公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

全体董事：

马 卓

李 铁

马 颖

杜 勇

洪 芳

刘木勇

全体审计委员会成员：

杜 勇

洪 芳

刘木勇

非董事高级管理人员：

吴玉梅

刘望兰

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2026年9月8日

七、发行人控股股东、实际控制人承诺

本公司控股股东、实际控制人承诺：深圳市迅捷兴科技股份有限公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

控股股东、实际控制人：

马 卓

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2026年9月8日

八、发行人董事会声明

（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

除本次发行外，公司将根据业务发展规划、项目投资进度等情况，并结合公司资本结构、融资成本等因素综合考虑是否实施其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律、法规履行相关审议程序和信息披露义务。

（二）关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施

1、积极稳妥推进募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力

本次募投项目的实施将使公司扩充业务规模、提升资金实力、抵御市场竞争风险、提高综合竞争实力。公司将加快募投项目实施，提升经营效率和盈利能力，降低发行后即期回报被摊薄的风险。

2、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

为规范募集资金的管理和使用，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于公司董事会审议通过的专项账户集中管理，做到专款专用、使用规范，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。

3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率

公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。

4、严格执行利润分配政策，保护投资者利益

公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益，建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护公司股东及投资者利益。

5、加强人才队伍建设，为公司发展提供人才保障

公司将建立与公司发展相匹配的人才结构，切实加强人力资源开发工作，引进优秀的管理人才，加强专业化团队的建设。建立更为有效的用人激励和竞争机制以及科学合理和符合实际的人才引进和培训机制，搭建市场化人才运作模式，为公司的可持续发展提供可靠的人才保障。

6、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

未来经营结果受多种宏微观因素影响，存在不确定性，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

（三）相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

1、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人承诺如下：

“（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

（2）切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（3）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会或上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

2、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）承诺对个人的职务消费行为进行约束。

（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（4）承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）承诺如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。

（7）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会或上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

（本页无正文，为《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》之发行人董事会声明盖章页）

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会



2026 年 9 月 8 日